



Electronics for the Future

2025年度上期 決算説明会

2025年11月7日

ローム株式会社

代表取締役社長 東 克己

-
- 業績報告
 - 中期経営計画
 - 事業戦略

(単位：億円)

	FY2025 上期実績			YoY	FY2025 通期修正計画			YoY
売上高	2,442	-		+5.3%	4,600	-		+2.6%
営業利益	76	3.1%		-	50	1.1%		-
純利益	103	4.2%		+398.9%	90	2.0%		-
期中平均レート(¥/US\$)	(146.57円)				(143.54円)			

上期実績

民生市場向けを中心に売上が増加。在庫による悪影響があったものの、償却費を中心に固定費削減した結果、赤字から黒字へ転換。

通期計画

下期の売上高は、季節トレンドもあり全体として低迷。また、金の建値高騰の影響により限界利益率が悪化。通期では黒字を維持するものの、下期は赤字となる見込み。

今後の在庫方針

製品については調整完了。パワーデバイスを中心に、仕掛品、原材料は調整を継続。

上期のSiC売上高

xEV向けSiCデバイスは中国・欧州向け、共に堅調に推移。

配当

中間配当は、1株当たり25円。期末配当も同様に1株当たり25円の予定。

東芝との業務提携

現在も協議中。なお、優先株式の一部が償還されたが、今後の協議に影響はなし。

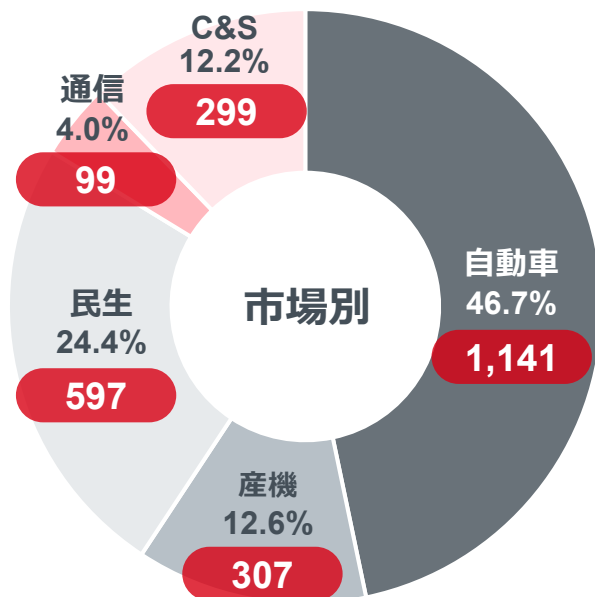
2024年度 上期

2,320億円

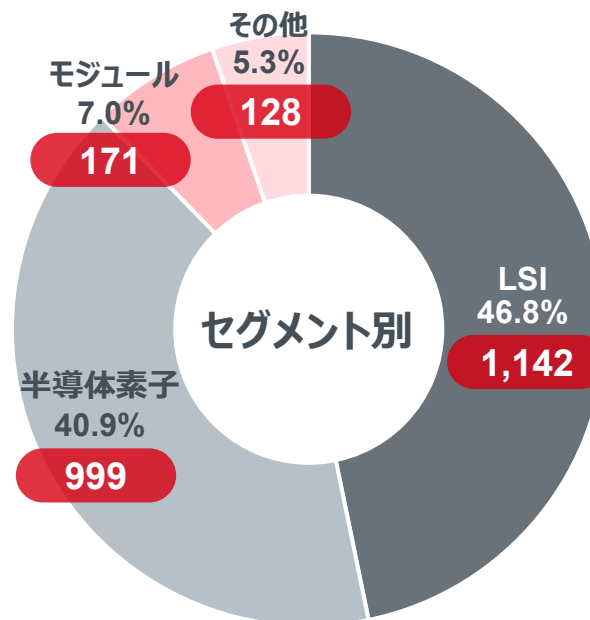
2025年度 上期

2,442億円 YoY +5.3%

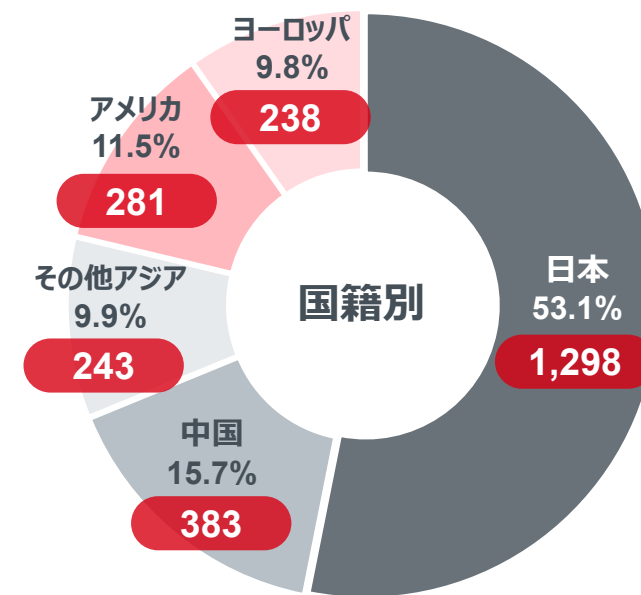
(単位：億円)



市場	YoY		
自動車	▲0.3%		
産機	+3.5%		
民生	+23.6%		
通信	▲10.8%		
C&S	+4.4%		

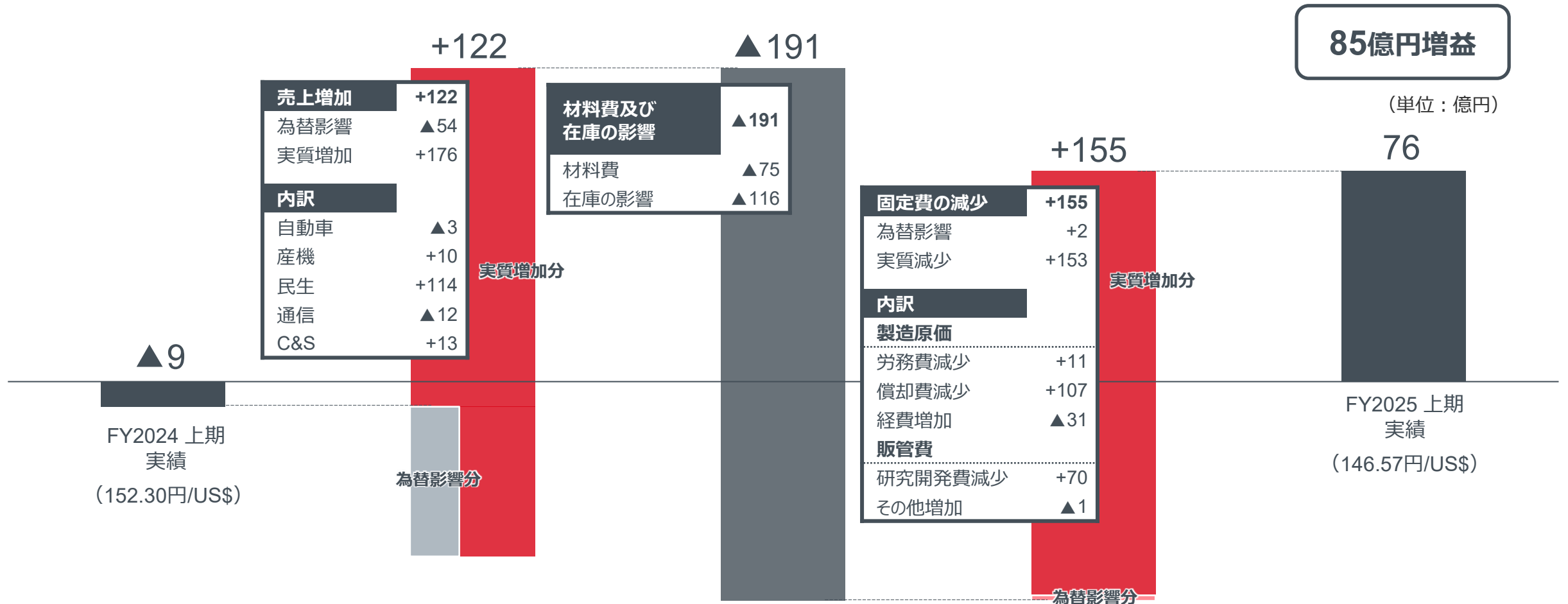


セグメント	YoY		
LSI	+9.6%		
半導体素子	+2.8%		
モジュール	▲3.4%		
その他	+0.8%		



国籍	YoY		
日本	+10.2%		
中国	+6.5%		
その他アジア	+0.6%		
アメリカ	▲5.0%		
ヨーロッパ	▲3.3%		

- 売上増の影響により限界利益が増加。
- 金建値高騰により変動費負担増。また在庫調整の影響が利益に対してネガティブに寄与。
- 固定費は、償却方法変更の影響の効果もあり償却負担が大きく減少。SiC事業に係る研究開発費負担はピークアウト。



市場	2025年度の見通し	1H	2H
自動車 (+0.2%)	■ 市場としてはボトムアウトしつつあるが、本格的な回復は来期以降になる見込み。 ■ 一方、SiCデバイスが欧州向け中心に堅調に推移。xEV分野の成長をけん引。	 ▲0.3%	 +0.6%
産機 (+1.9%)	■ 長期化していた顧客の在庫調整が概ね解消。 ■ エネルギー分野向けSiCデバイスが欧州向け中心に伸長。	 +3.5%	 +0.1%
民生その他 (+6.0%)	■ 上期好調だった白物家電向けが10月以降に減速する見通し。 ■ アミューズメント向けの売上が大幅に増加するが、季節性として7～9月でピークアウト。 ■ PC向けやサーバー向けが堅調に推移する見込み。	 +13.0%	 ▲1.8%

括弧内はローム売上高YoY

【YoY】
前年比



+10%～



+10%～+2%



+2%～▲2%



▲2%～▲10%



▲10%～

2024年度 通期

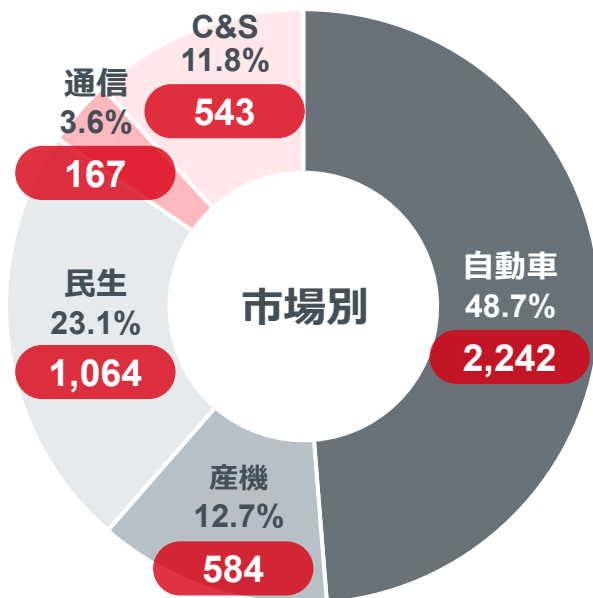
4,484億円

2025年度 通期

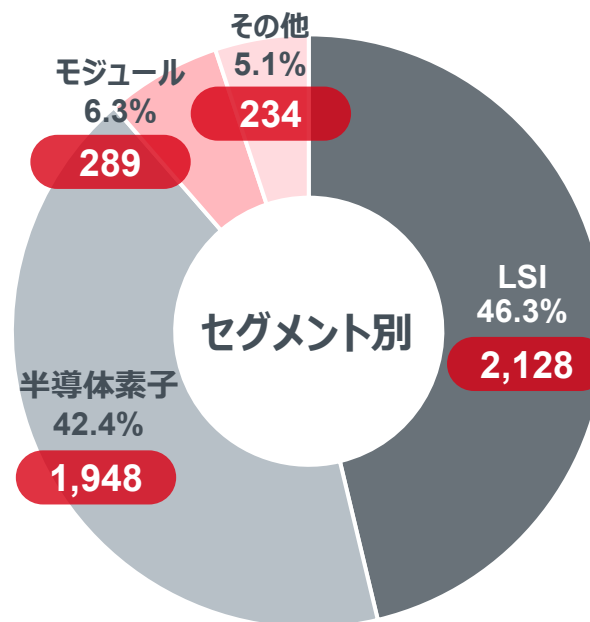
4,600億円

YoY +2.6%

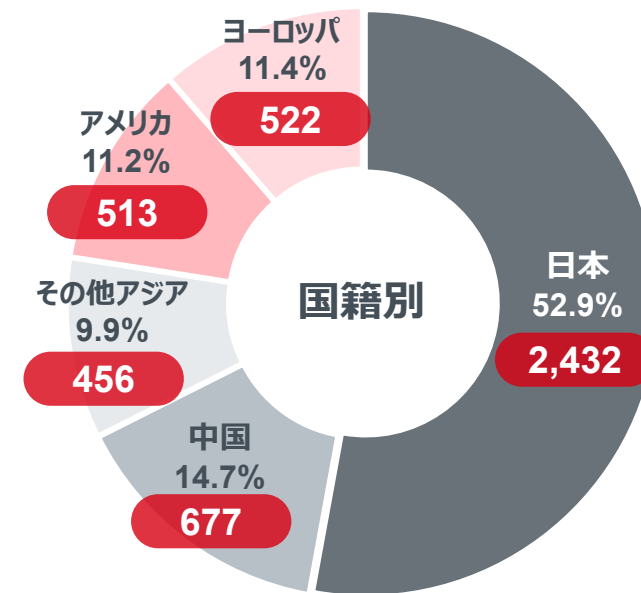
(単位：億円)



市場	YoY		
自動車	+0.2%		
産機	+1.9%		
民生	+14.0%		
通信	▲14.9%		
C&S	▲0.1%		

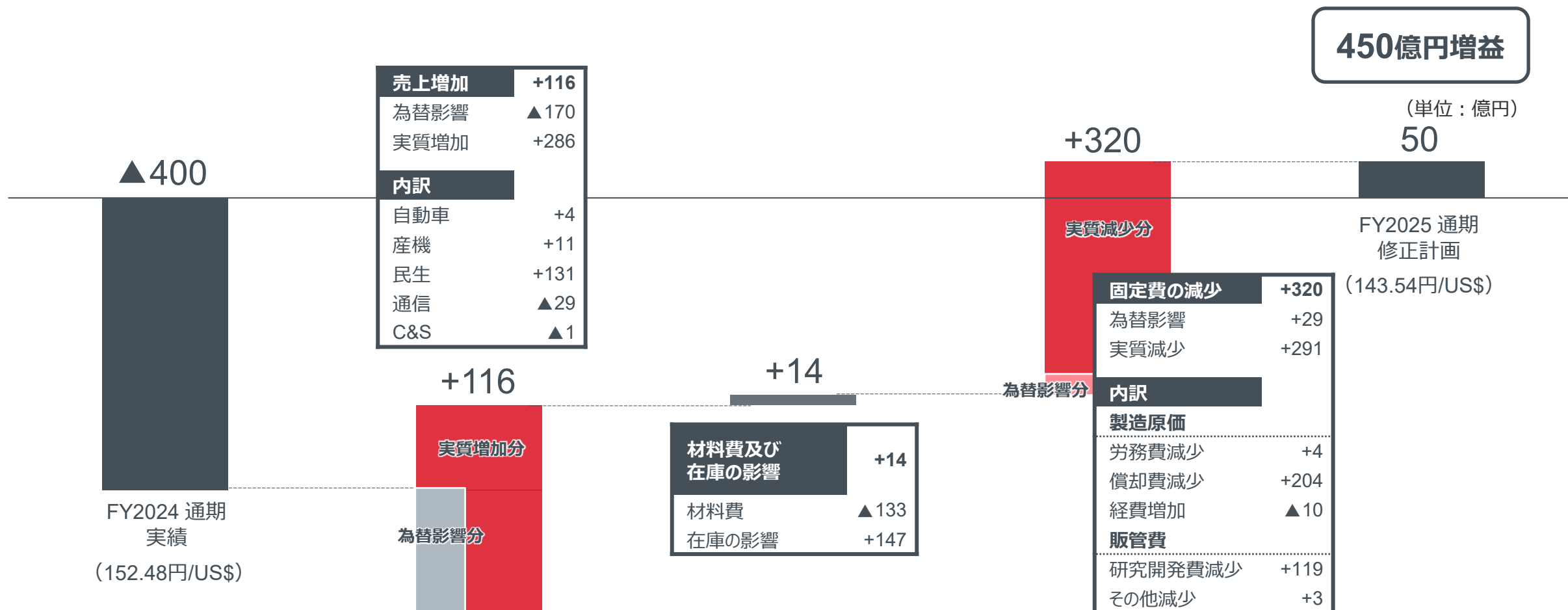


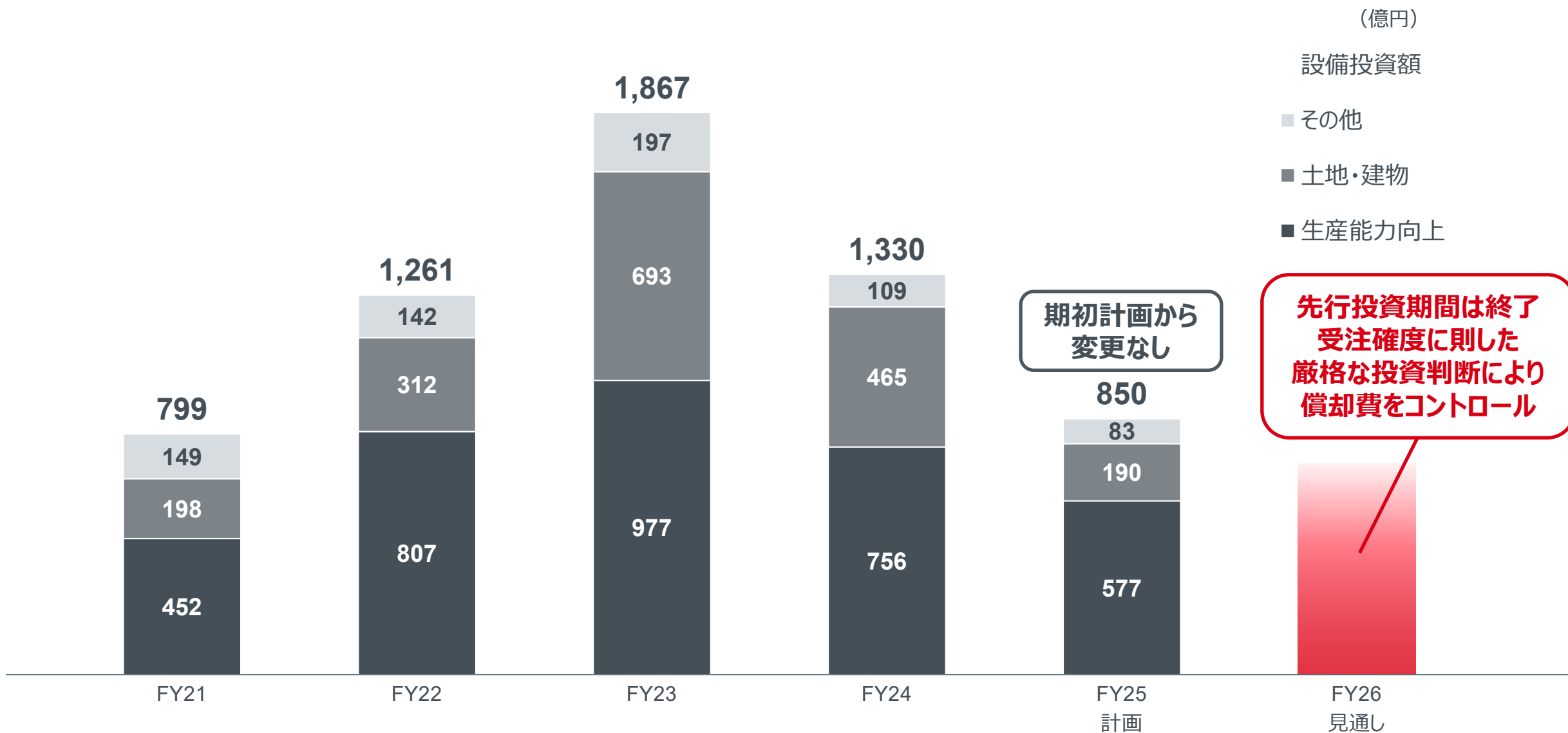
セグメント	YoY		
LSI	+4.4%		
半導体素子	+4.1%		
モジュール	▲11.1%		
その他	▲6.3%		



国籍	YoY		
日本	+3.7%		
中国	+1.0%		
その他アジア	+0.6%		
アメリカ	▲4.9%		
ヨーロッパ	+9.4%		

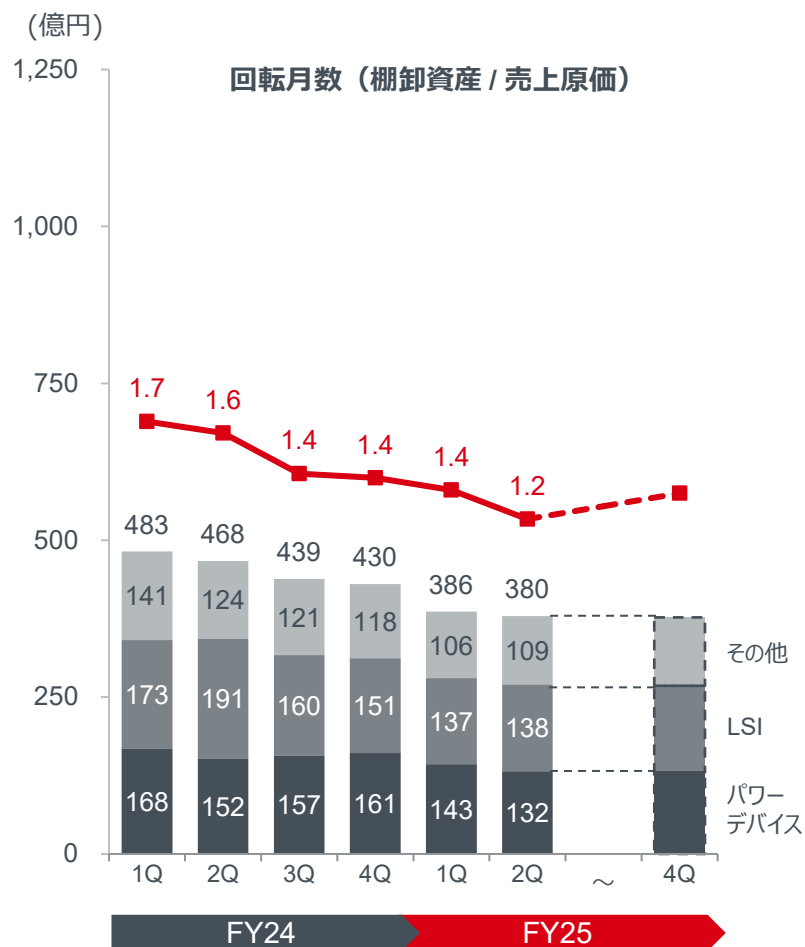
- 売上は増加する見込みだが、下期に更に加速した**金建値高騰の影響額が大きく**、限界利益額は減少。
- 在庫の影響はFY24に計上した評価減の反動により増益に寄与。
- 固定費は、償却方法変更の影響の効果もあり償却負担が大きく減少。SiC事業に係る研究開発費負担はピークアウト。





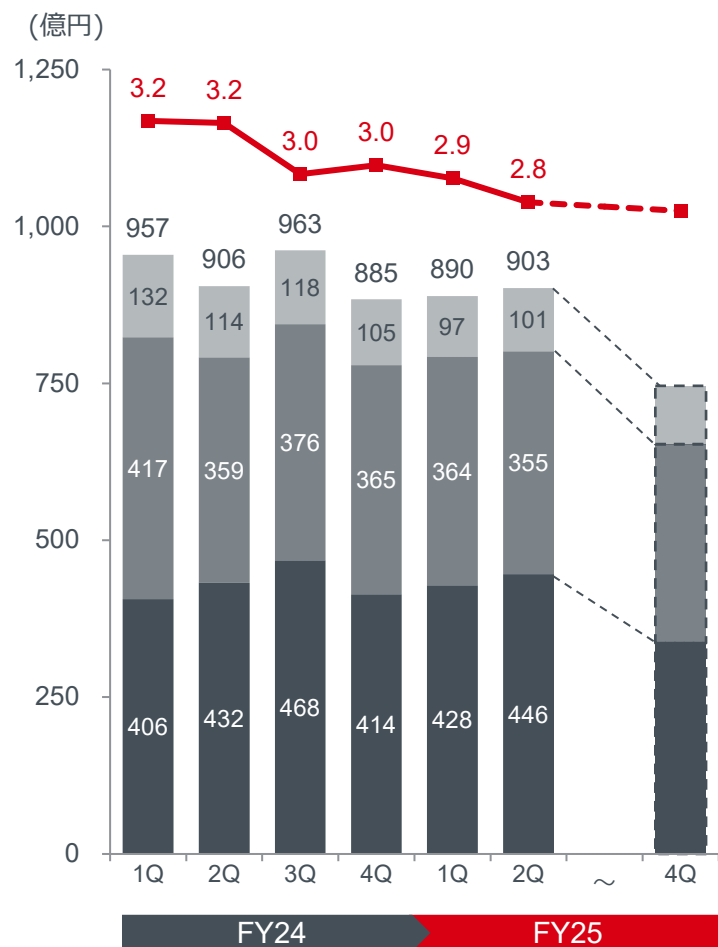
■ 商品及び製品

在庫調整は完了。現在の水準を維持。



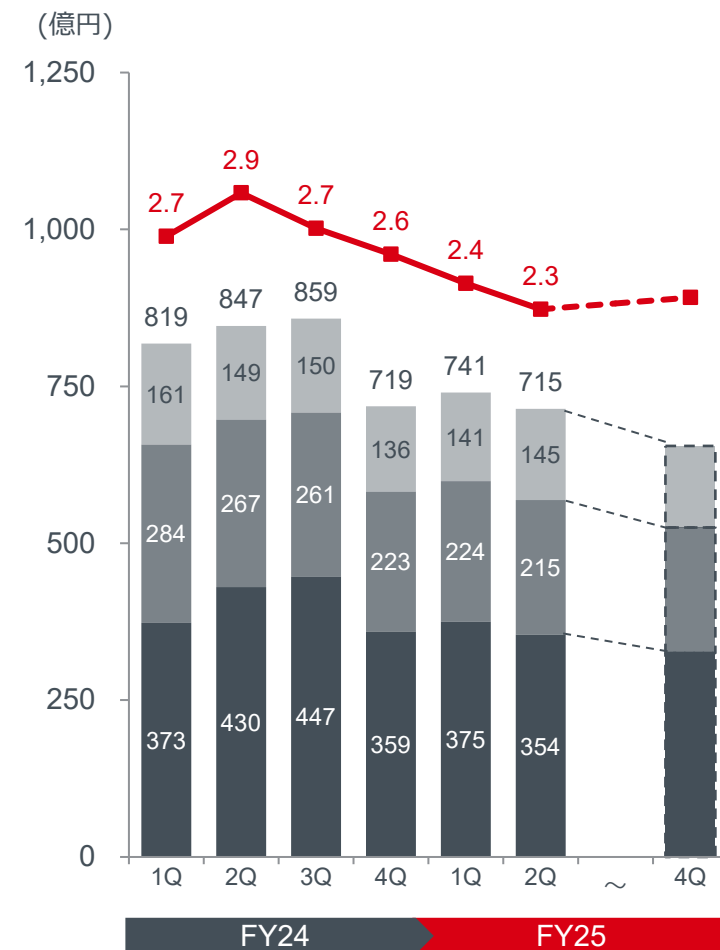
■ 仕掛品

期末に向け、パワーデバイスを中心に
もう一段階調整を進める。



■ 原材料及び貯蔵品

LTAにより過剰になっている在庫の調整を継続。



配当性向	27%
総還元性向	27%

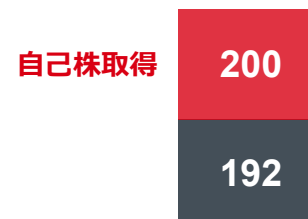
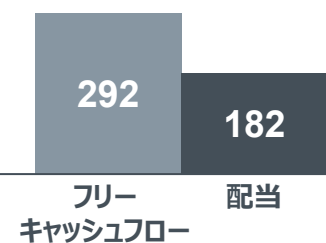
配当性向	24%
総還元性向	24%

配当性向	36%
総還元性向	73%

配当性向	-%
総還元性向	-%

配当性向	215%
総還元性向	215%

(単位：億円)



2023年9月30日を基準日として1株につき4株の割合で株式分割を実施
(FY22以前の1株当たり配当金は当該株式分割が行われたと仮定して記載)

FY21	
年間配当	45円
中間	18円
期末	27円

FY22	
年間配当	50円
中間	25円
期末	25円

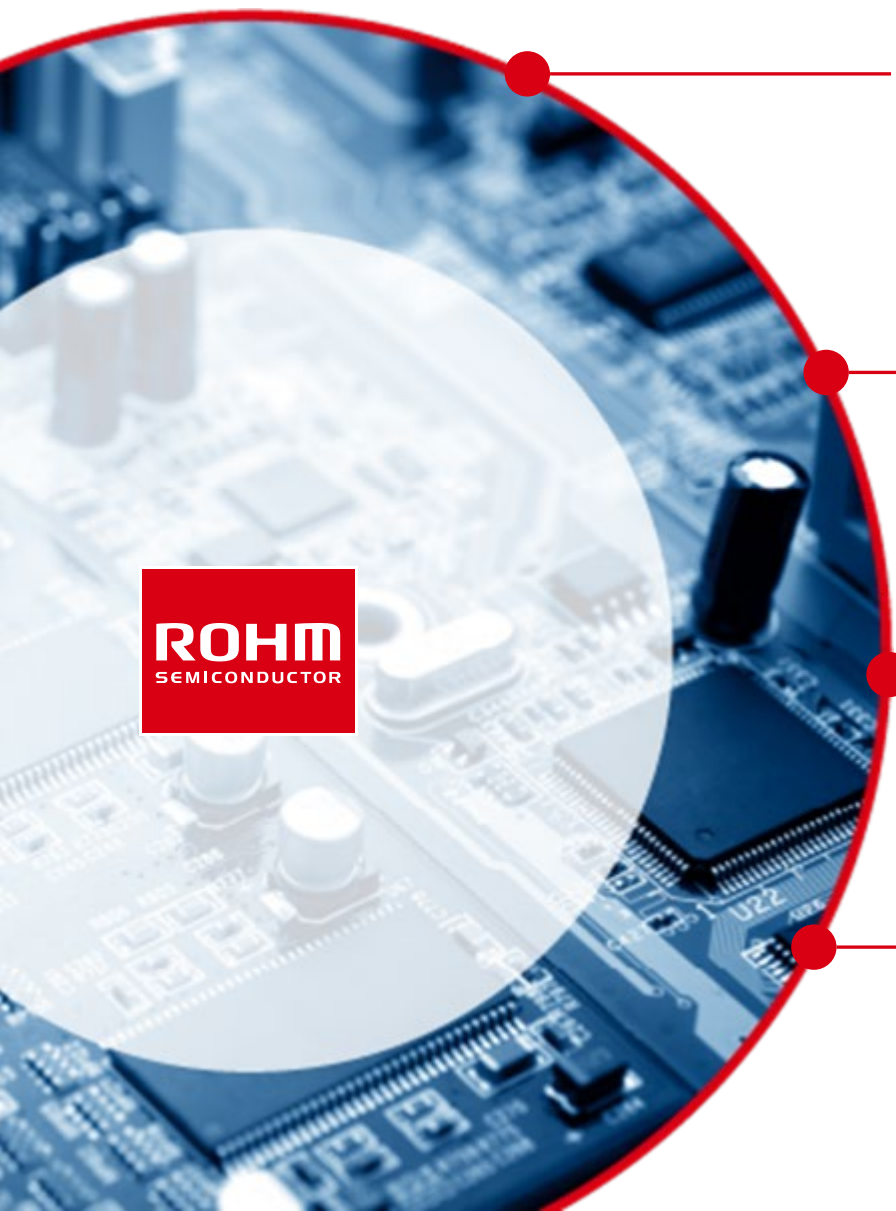
FY23	
年間配当	50円
中間	25円
期末	25円

FY24	
年間配当	50円
中間	25円
期末	25円

FY25 (計画)	
年間配当	50円
中間	25円
期末	25円

*フリーキャッシュフロー：純利益 + 減価償却費 + 減損損失 - 設備投資

- 業績報告
- 中期経営計画
- 事業戦略



企業目的

われわれは、つねに品質を第一とする。

いかなる困難があろうとも、良い商品を国の内外へ永続かつ大量に供給し、文化の進歩向上に貢献することを目的とする。

ステートメント Electronics for the Future

ロームは、エレクトロニクスの技術で、社会が抱える様々な課題を解決し、未来に向けて、人々の豊かな暮らしと、社会の発展を支え続けていきます。

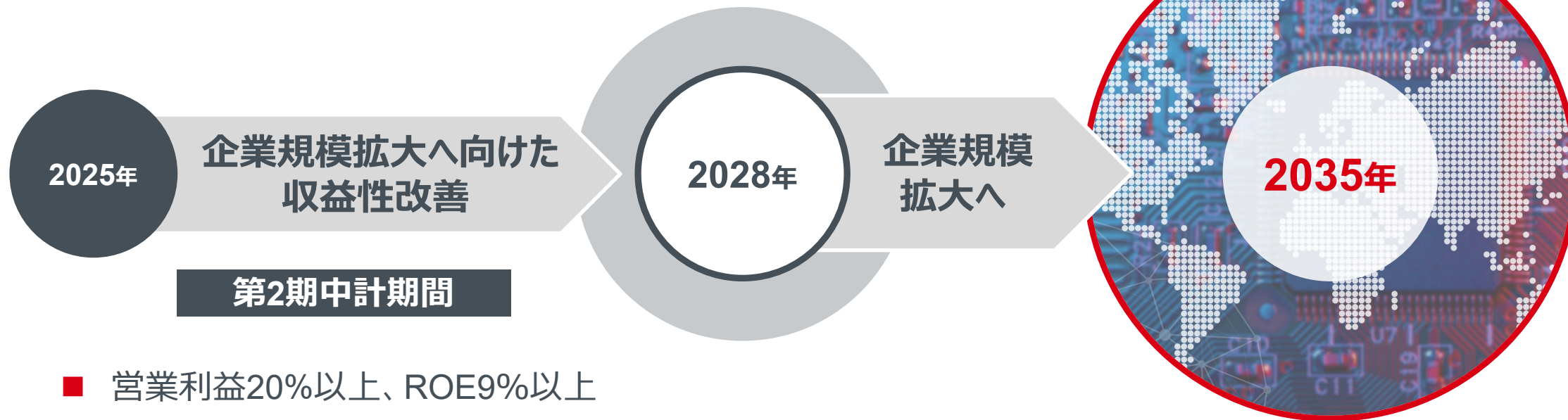
経営ビジョン

パワーとアナログにフォーカスし、お客様の“省エネ”・“小型化”に寄与することで、社会課題を解決する。

会社の目指す姿

半導体技術で存在感を示すグローバル企業へ
～パワー・アナログ半導体の分野で世界トップ10～

第2期中計では、将来の企業規模拡大に向けた収益性の改善を行い、グローバルで競合に伍して戦える状態まで持っていく。



- 営業利益20%以上、ROE9%以上
- 抜本的な構造改革
- SiCの収益化(黒字化)の実現

会社の目指す姿

半導体技術で存在感を示すグローバル企業へ
～パワー・アナログ半導体の分野で世界トップ10～

日本だけでなく世界の顧客に対して
「存在感」を示すことの出来ている企業を目指す

財務目標 (2028年度)

売上高	5,000 億円以上
営業利益	20% 以上
ROE	9% 以上

非財務目標 (抜粋)

環境 (2030年度)	■ 温室効果ガス排出量50.5%削減 (2018年度比) ■ 再生可能エネルギー 2050年度導入比率100%へ向け推進 ■ 廃棄物ゼロエミッション化
人財戦略と 企業の 持続的成長	■ サクセッションプラン充足率 300% ■ 変革実行力教育 コア人材受講率100% ■ 株式報酬制度の拡充

創業以来培ってきた強みを進化/深化させ、これからも成長する。

ロームの強み

顧客志向

- 顧客の要望を吸収し、真に必要とされるソリューションの提案力
- 顧客対応力(対応スピード)

尖った技術

- 社会課題を解決する常識に捉われない“開発力”
- イノベーションの積み重ねで培われた“ものづくり力”

ロームの特長(支える土台)

IDM

- 徹底した品質管理、安定供給
- IDMの強みを生かした創意工夫

すり合わせ技術

- 顧客の真の課題を解決する開発力
- スペシャリストと豊富なインテグレーター人財

パワー・アナログ技術

- 常に進化するローム独自の技術
- 長年培われた知識と経験

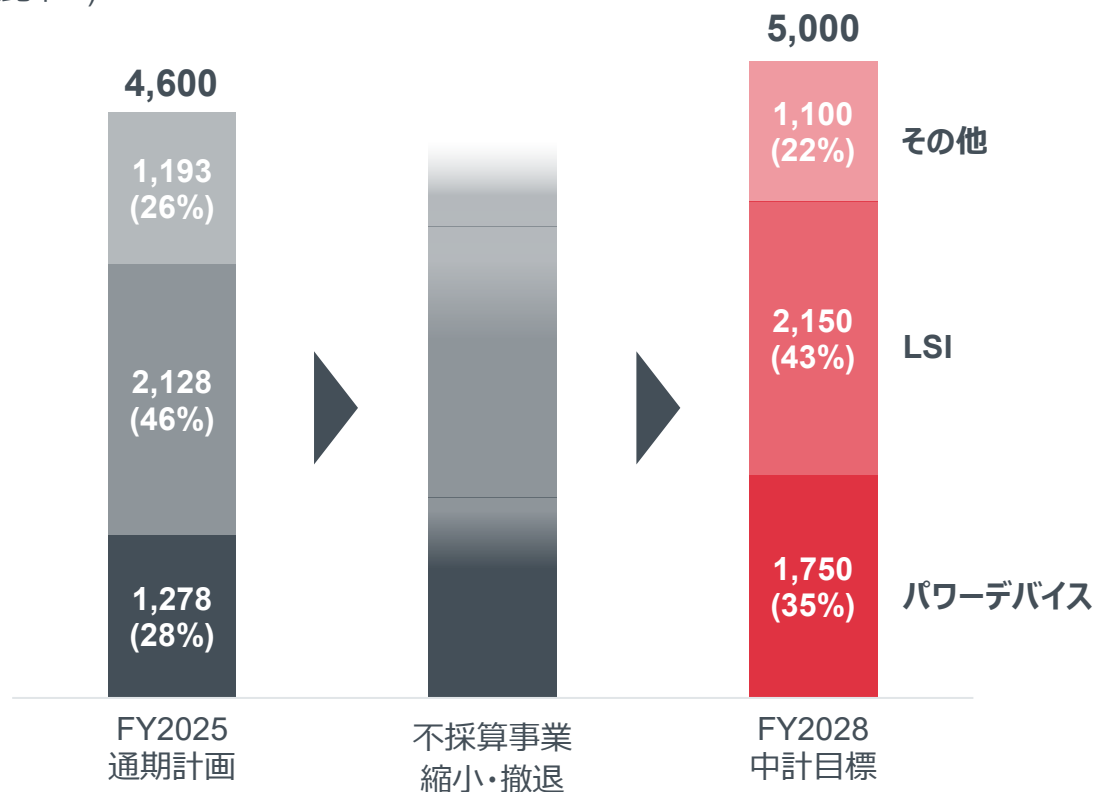
- パワー・アナログを軸に自動車での成長を実現しつつ、産機と民生その他(サーバー、家電 等)も強化し、バランスの良いポートフォリオへ
- センシング向けオプティカルデバイスへの注力を進め、次世代の柱として育てる

	自動車	産機	民生・通信・C&S
伸ばす	■ xEV向け絶縁ゲートドライバ ■ HUD/クラスター向け画像処理LSI ■ ECU保護用IPD	■ 電源LSI、システム保護用IPD ■ FA/ロボット向けモータードライバ ■ FA用LiDAR向けレーザーダイオード	■ サーバー向け Si MOSFET ■ 家電向けIPM ■ ストレージデバイス向け電源LSI ■ スマホカメラ用ホールセンサ
進化する	■ IGBT / 48V系LV MOSFET	■ 低容量TVSダイオード / シリコンキャパシタ/ シャント抵抗	■ サーバー向けSiC MOSFET
	■ LiDAR向けレーザーダイオード	■ 半導体リレー向けVCSEL	
創る	■ 48Vシステム対応 電源LSI ■ MCU内蔵ドライバ	■ FA/スマートホーム向け Solist-AIマイコン	■ サーバー向け MPC+Dr MOS ■ 家電/モバイル機器向け LASCA ■ フォトニック結晶レーザーダイオード

事業別

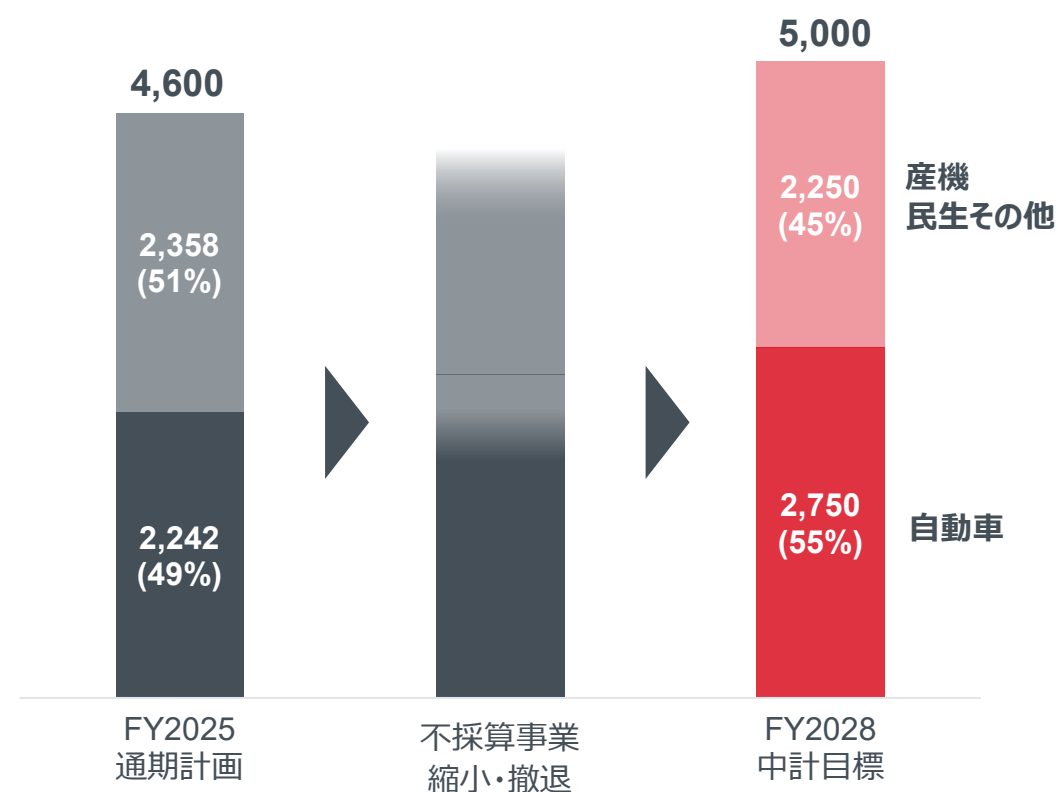
- パワーデバイス、LSI（アナログを軸）が成長を牽引
- 不採算製品についてEOLを実施

単位:億円
(売上比率%)



市場別

- 自動車での成長を維持しつつ、民生その他も強化
- サーバー関連の目標であるFY30で売上300億円までの道筋を作る



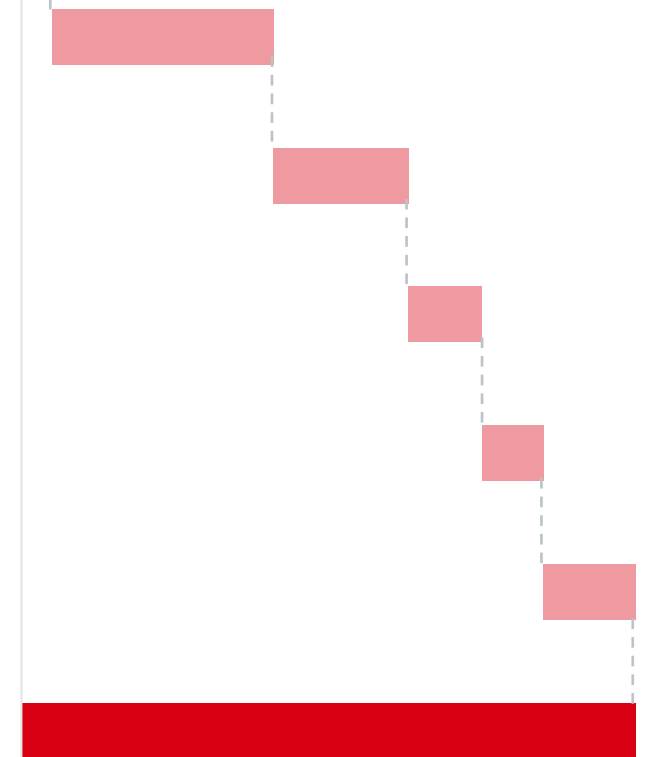
全社変革をクロスファンクション体制で推進し、収益構造を抜本的に改善する

- SiC事業の収益化、構造改革が1,000億円の達成を牽引
- 不採算事業の縮小・撤退による売上ダウンがあるものの、それを打ち消す売上成長を実現

(単位：億円)

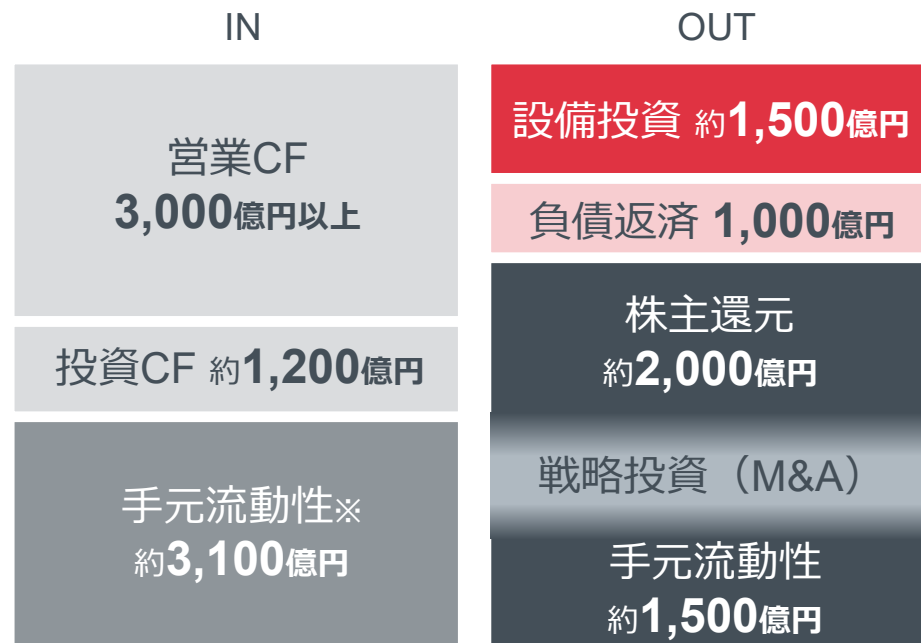
		FY25→FY28 利益改善額
SiC事業の収益性改善	■ シェアUP、次世代デバイス、高付加価値モジュール ■ 8インチ化、歩留り向上、投資適正化	340 - 400
生産拠点再編 事業ポートフォリオ適正化	■ 生産ライン移設・拠点統廃合 ■ 不採算事業の縮小・撤退	180 - 220
製造コストダウン 調達コスト適正化	■ 人生産性改善、製造経費、付帯費用 ■ VA/VEによる原価低減	90 - 120
価格適正化 業務効率改善	■ プライシング戦略の見直し ■ 業務プロセス再設計、DXによる固定費適正化	70 - 100
売上成長（SiC事業除く）	■ 車載の更なる成長とAIサーバ向けに注力 ■ 不採算事業の縮小・撤退を打ち消す売上成長	140 - 200
FY2028営業利益		1,000

FY2025 通期計画



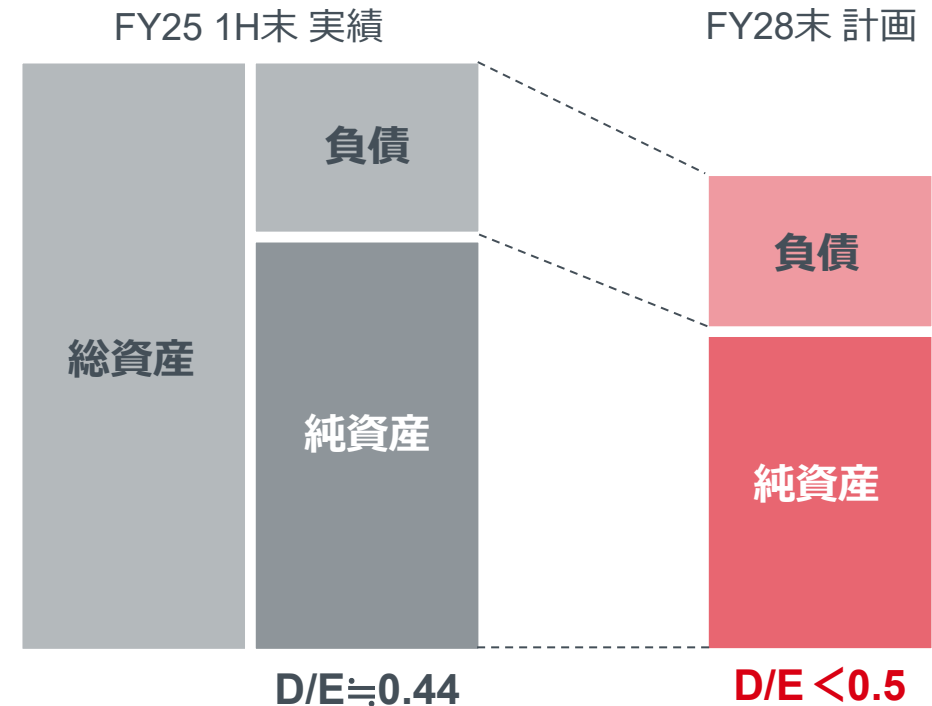
- **キャッシュ創出**：業績回復、CCC改善による運転資本の縮減、非事業性資産の適正化、投資有価証券売却
- **株主還元**：安定配当と自己株式取得による資本効率の大幅改善（配当性向＞30%、総還元性向＞100%）
- **設備投資**：適正水準へ抑制（生産拠点再編、維持管理、R&D）
- **財務規律**：純資産適正化に伴う負債の圧縮（D/E＜0.5）
- **手元資金**：売上の3ヶ月分程度へ圧縮

キャッシュアロケーション（FY26～FY28 3年累計）



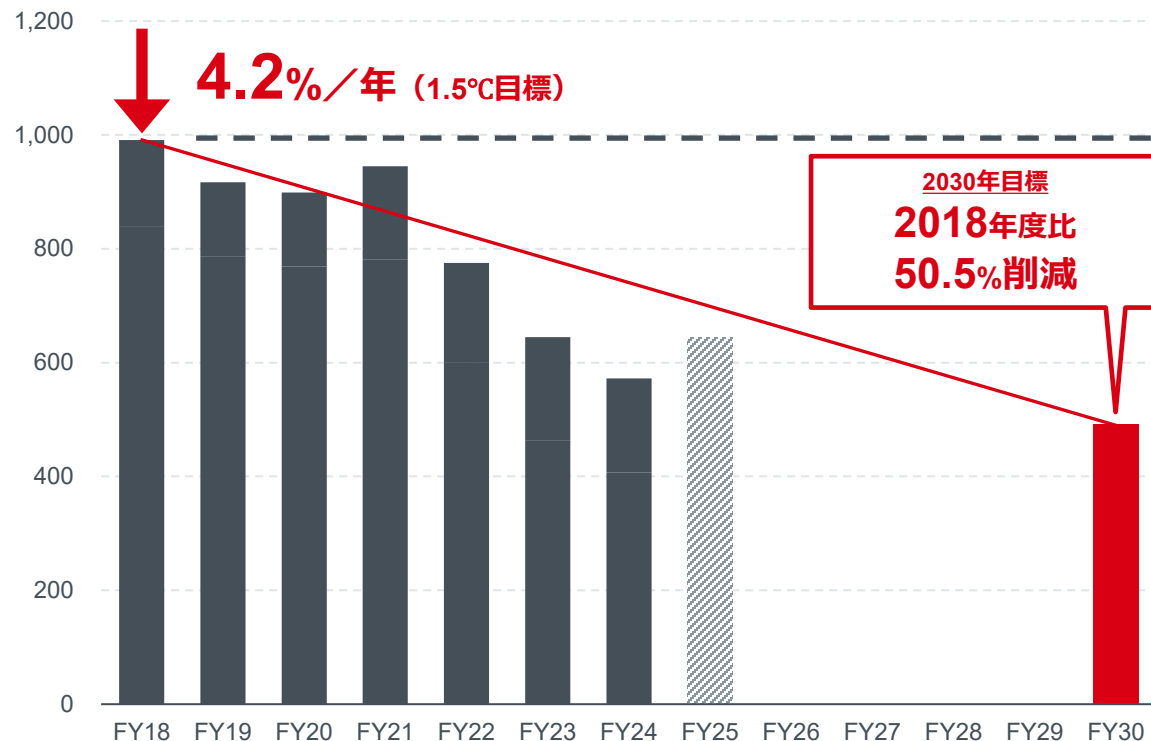
※FY2025 1H末時点

資本構成



事業環境への取り組み

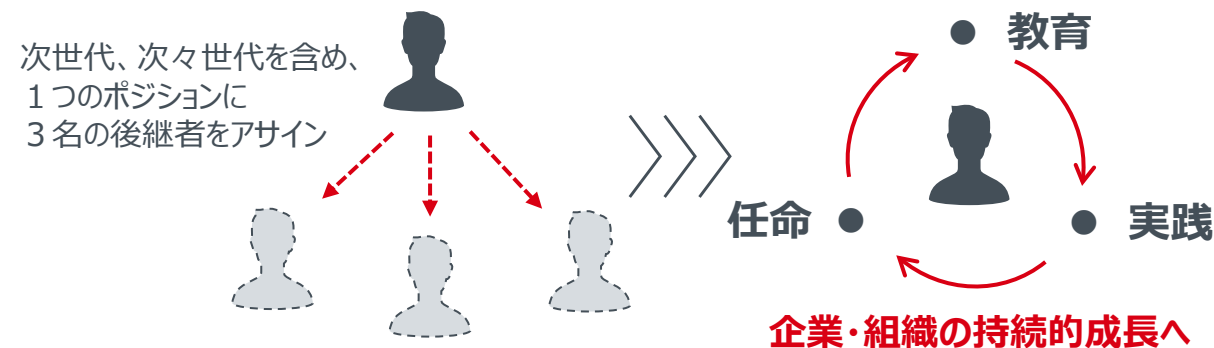
SCOPE1&2におけるGHG排出量推移(千t-CO2)



- 2025年度は年率4.2%削減目標ラインに沿うよう再エネ導入量調整
- 2024年度は生産量減少と計画前倒しの再エネ導入の影響でGHG排出量削減

人的資本への取り組み

サクセッションプラン充足率300%



株式報酬制度の拡充



-
- 業績報告
 - 中期経営計画
 - 事業戦略

LSI事業の位置づけ

収益性を大きく改善し、全社の利益率を牽引する事業へ

FY2028目標

売上高

2,150億円以上

営業利益

23%以上

第2期中期経営計画期間中の主な施策



製品ポートフォリオの適正化

低収益分野から高収益&成長分野へ開発リソースを振り向け、製品ラインアップを拡充する



独創的な技術開発による競争力の確保

チップレット、高効率DrMOS、オンデバイス学習AI、IPD製品など



開発効率の向上、開発リードタイムの短縮

独自シミュレーションの開発と、その運用による手戻りの徹底排除など



生産性向上、変動費削減、歩留まり向上による収益性向上

量子アニーリング適用による工程流動の最適化やAu材高騰への対処など

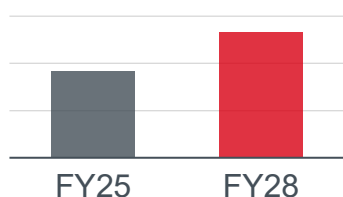
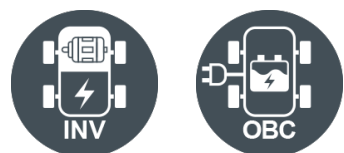


生産拠点の統廃合による、固定費削減

自動車向けで成長しつつ、産機・民生を強化し、バランスの良いポートフォリオへ

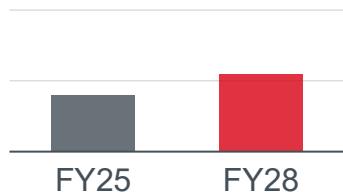
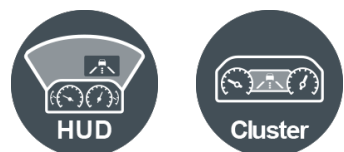
【車載】今後3年間で伸びるROHM車載分野 Top3

絶縁ゲートドライバ xEV生産台数増加による数量増



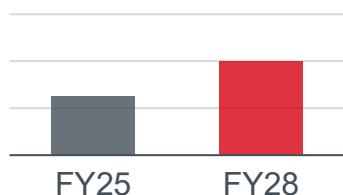
FY25比
1.5倍

画像処理 高解像度新商品の単価UPによる売上増



FY25比
1.4倍

IPD 受注済大型案件 量産開始により売上増



FY25比
1.6倍

【産機・民生その他】新製品投入による市場開拓



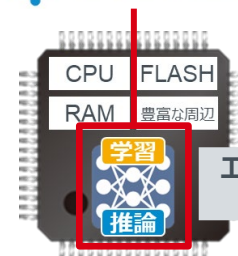
Solist-AI™

ネットワーク不要で学習・推論し、設備の異常を予測可能

2025 超モノづくり部品大賞
「電気・電子部品賞」受賞

Solist-AI

超モノづくり
部品大賞



いつもと違うを検出/推定寿命を推測

エンドポイントに
実装

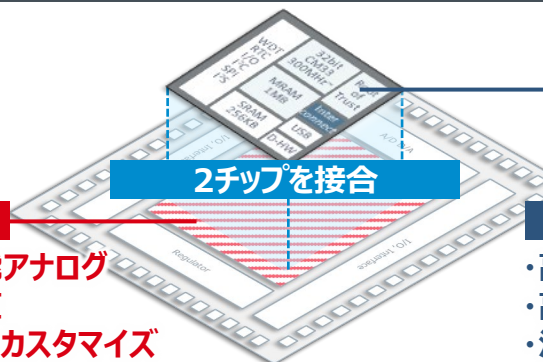


想定アプリケーション

- スマートホーム
- ウェアラブルデバイス
- 患者モニタリングデバイス
- 工場機械・ロボット制御 等

LASCA™

チップレット技術によりアナログ・パワーと高性能デジタル制御を融合



ローム
・高性能アナログ
・高耐圧
・柔軟なカスタマイズ

ファンダリ
・高速CPU
・高速メモリ
・汎用回路を高集積

想定アプリケーション

- エアコン室外機の
モーター・電源制御
- センサー制御
- ウェアラブルデバイス

PD事業の位置づけ

SiC事業の黒字化を達成 成長ドライバとして利益に貢献

FY2028目標

売上高

1,750億円以上

営業利益

14%以上

第2期中期経営計画期間中の主な施策



SiC事業のxEV向けインバータ市場売上拡大



SiCモジュール/ディスクリートの新商品ラインアップ拡充

産機向け高耐圧デバイス開発、高性能モジュール開発による市場拡大



SiC MOSFETの開発を前倒し、性能の進化とコストダウンに寄与

5th Genは計画通り量産体制確立、6th Gen以降はリリース予定時期前倒し

SiCウエハプロセス歩留まり改善、8インチ化による利益改善



Si MOSFETをAIサーバーおよび自動車市場で売上拡大

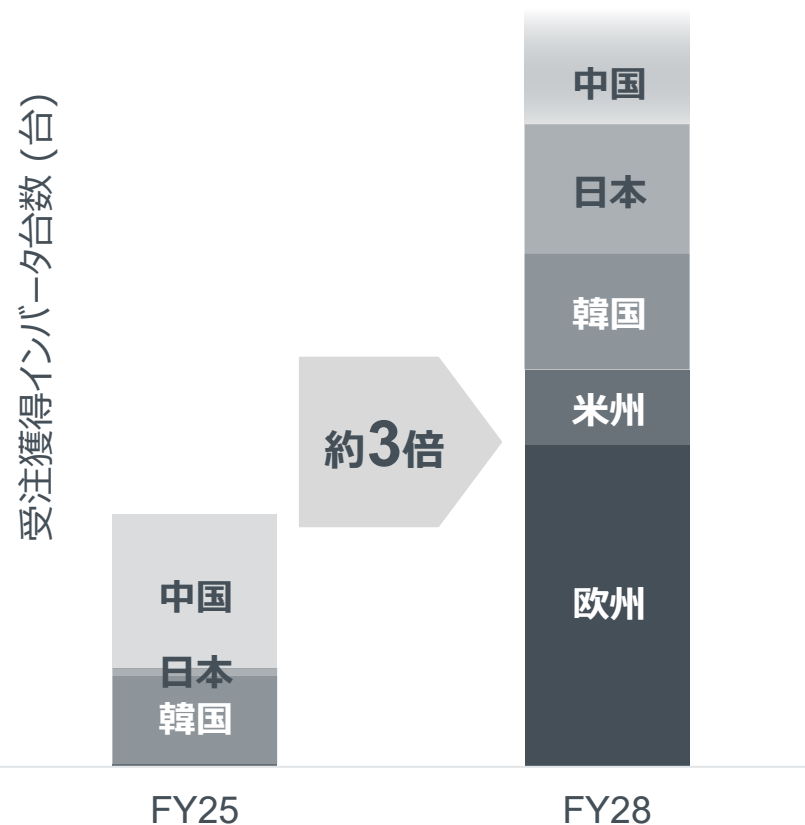


製品ポートフォリオ見直し、拠点戦略で事業収益性を改善

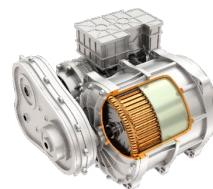
■ 主機インバータ

OEM地域別 受注獲得状況

※地域：OEM本社所在地ベース

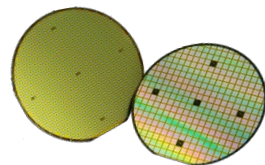


主機インバータ向けビジネス



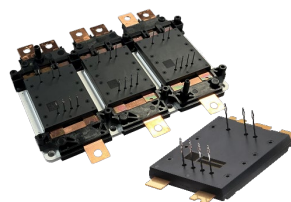
- 現時点でOEM 16社に納入決定
- 2028年 約3百万台のインバータ台数に相当

SiCベアチップ



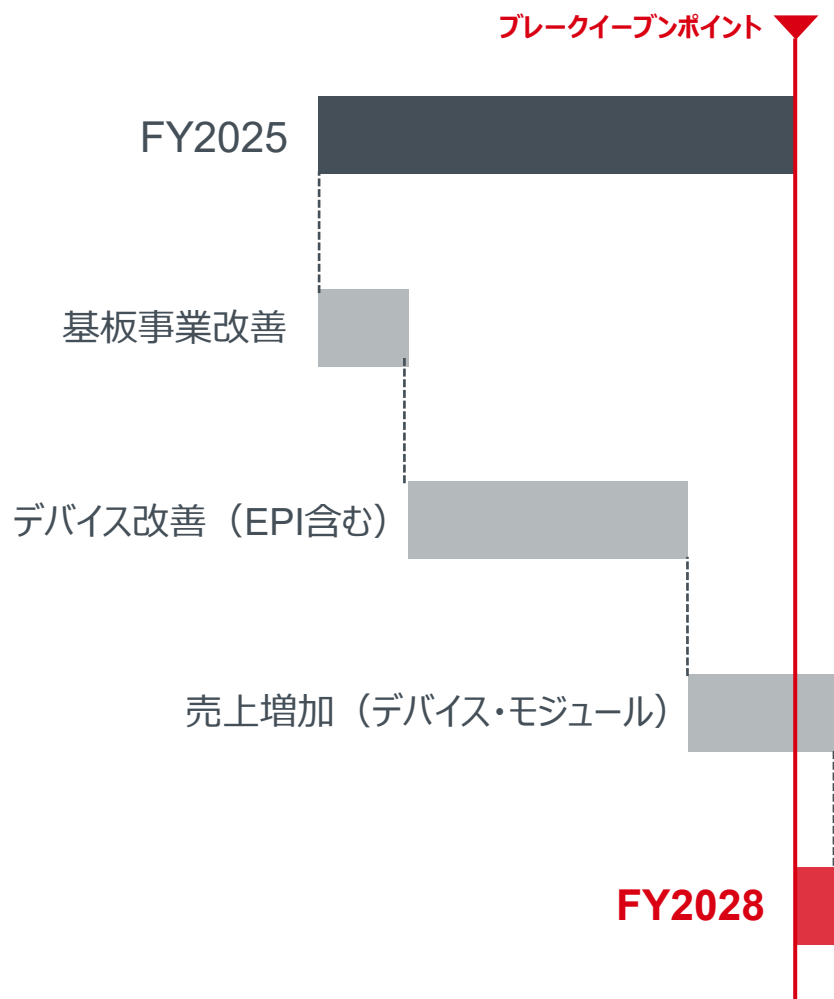
- 欧州、日本、米州のOEM案件拡大により、特定地域に依存しない盤石な販売基盤を確立
- BEVだけでなくPHEV/HEVへのSiC採用拡大
- 第5世代の市場投入により競争力向上

SiCパワーモジュール



- TRCDRIVE pack™の納入開始
- モジュールビジネス比率増加により、売上伸長

黒字化への道筋



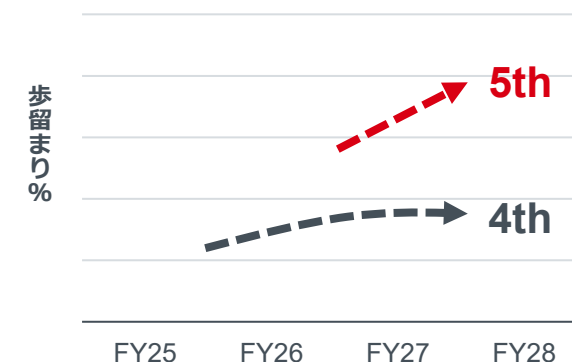
エピ内製化によるコスト削減

- 8インチライン増強および生産スループット改善により内製化率を向上



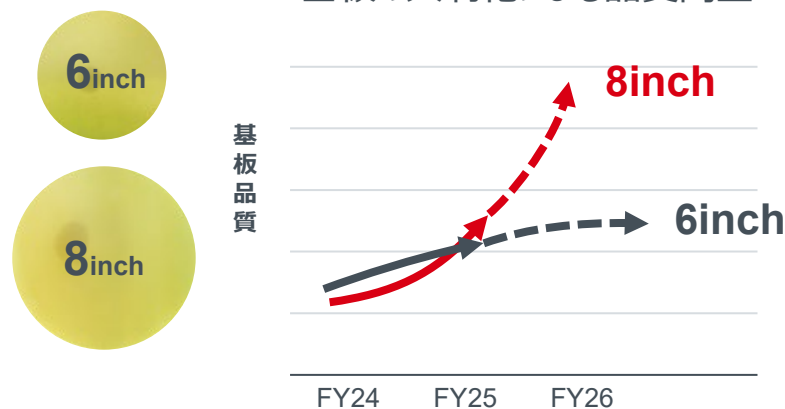
歩留まり改善

- デバイス世代更新により改善を加速

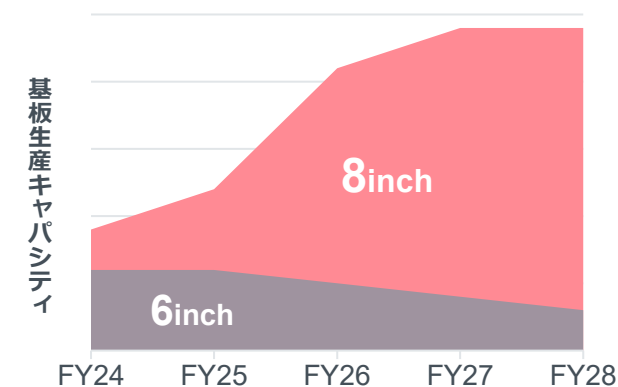


SiC基板 品質・生産能力向上

- 基板の大判化による品質向上



- 高品質な8インチのキャパシティを増強



汎用・その他事業の
位置づけ

高シェアを維持 キャッシュカウ事業として全社を下支え

FY2028目標

売上高

1,100億円以上

営業利益

22%以上

第2期中期経営計画期間中の主な施策



製品ポートフォリオの適正化

高収益機種拡大と低収益機種のEOL



センシング向けオプト技術の進化、次世代の柱へ



生産性向上、変動費削減、歩留まり向上による収益性向上

(前工程の8インチ化の促進、Au使用量削減 etc.)

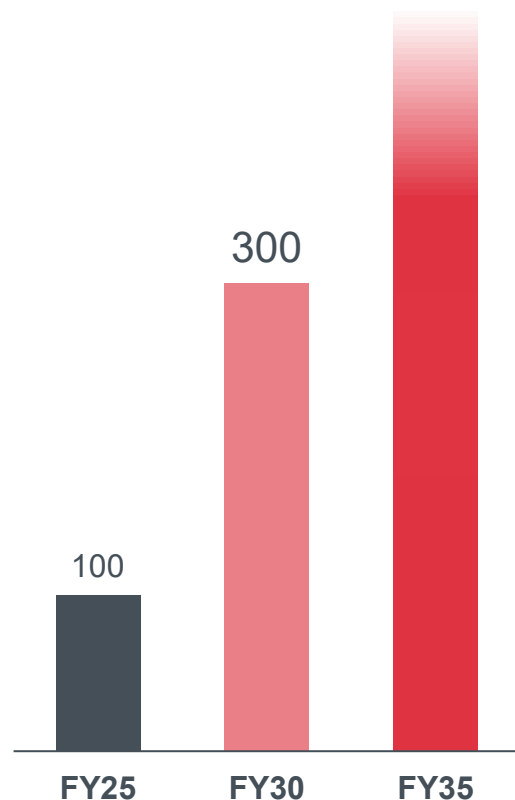


生産拠点の統廃合による、固定費削減

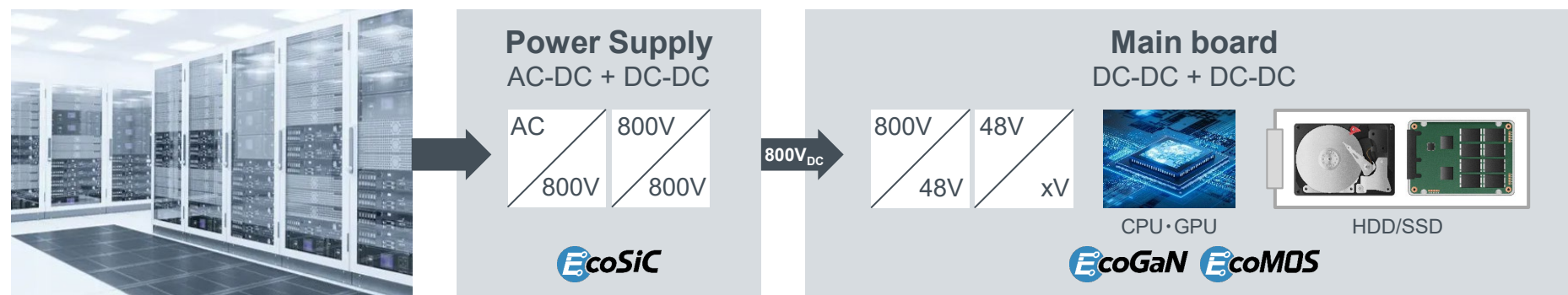
AIデータサーバーを中心に、ローム各製品の採用が急加速中

サーバー向け売上目標

(億円)



製品ラインアップ



Power				Analog			Others	
SiC MOSFET	GaN HEMT	Si MOSFET		MPC + Dr MOS	HSC	SSD PMIC	Shunt Resistors	Si Capacitor
DOT-247	GNP2070TD-Z	RY7P250BM	RS7N200BH		BD12780MUV	BD72649GWV		
Low Ron	Low FOM*1	Wide SOA/Low Ron		High speed control	High speed response	High efficiency	Small and High accurate TCR	Low loss

*1:FOM(Figure of merit) = Ron*Qoss

＜ご注意事項＞

1. 当資料は投資分析を目的として作成しておりますので、投資分析にのみご使用ください。
2. 2025年度通期の予想は、現時点で得られた情報にもとづいております。従って、業況の変化などにより記載の予想と大きく異なる場合があります。

＜お問い合わせ先＞

ローム株式会社 IR室
〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21
E-mail : ir@rohm.co.jp



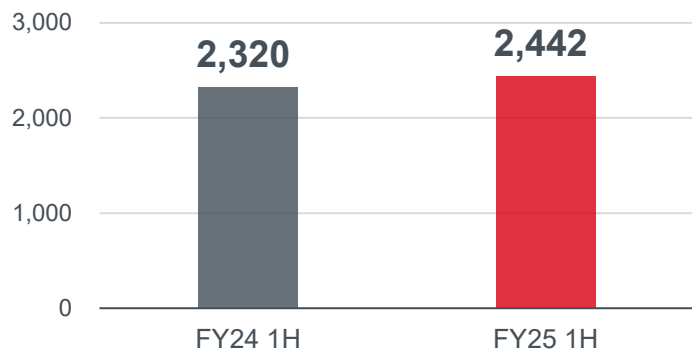
Electronics for the Future

(単位：億円)



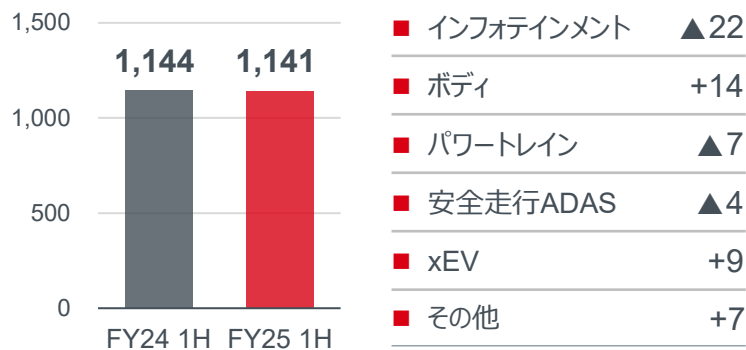
上期売上高

+5.3%



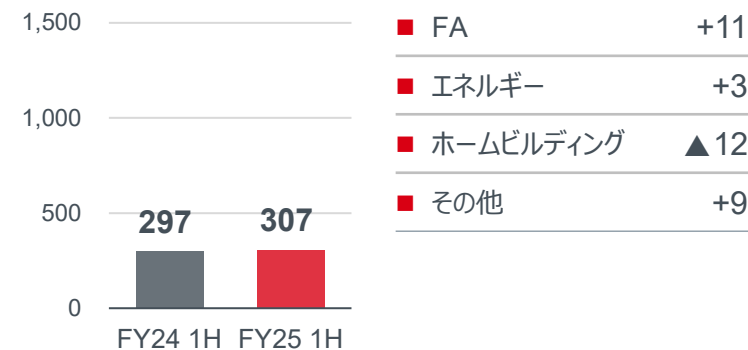
自動車

▲0.3%



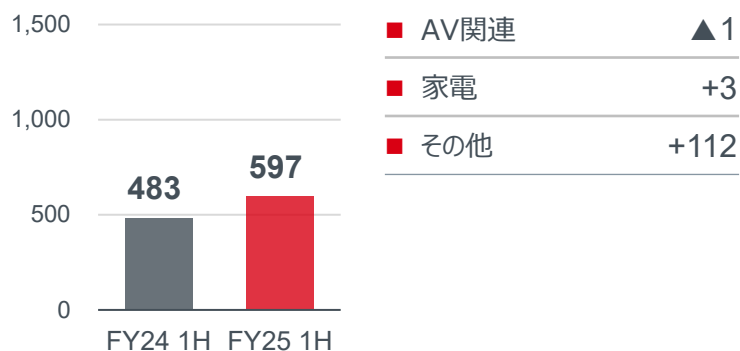
産機

+3.5%



民生

+23.6%



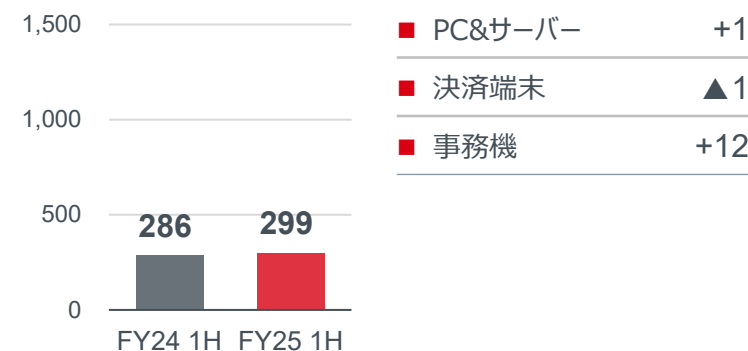
通信

▲10.8%



コンピュータ & ストレージ

+4.4%



[2025年度 上期 国籍別] 売上の変動要因 (YoY)

上期
売上高

2,320億円

FY2024 1H実績

2,442億円

FY2025 1H実績

+5.3%

海外売上高
比率

49.3%

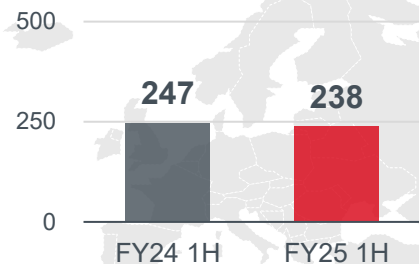
FY2024 1H 実績

46.9%

FY2025 1H実績

欧州

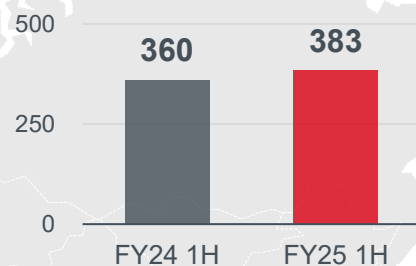
▲3.3%



自動車	▲10	通信	+0
産機	+0	C & S	+4
民生	▲2		

中国

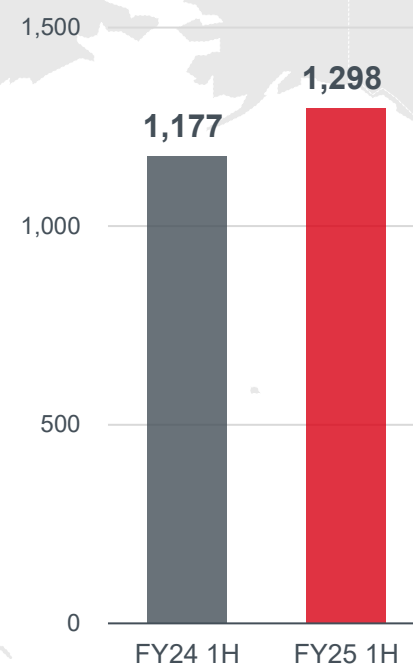
+6.5%



自動車	+10	通信	+5
産機	▲3	C & S	+2
民生	+9		

日本

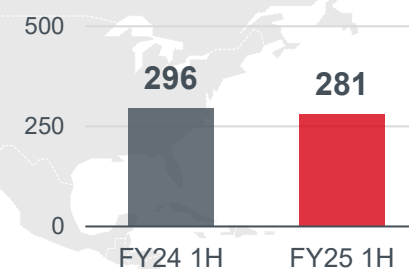
+10.2%



自動車	▲3	通信	▲4
産機	+0	C & S	+7
民生	+119		

米州

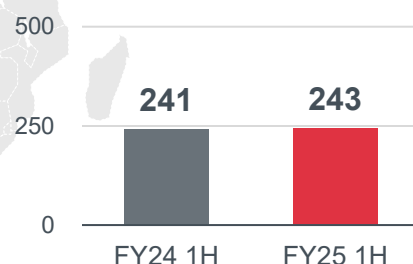
▲5.0%



自動車	+1	通信	▲10
産機	+8	C & S	▲7
民生	▲7		

その他アジア

+0.6%



自動車	▲2	通信	▲3
産機	+5	C & S	+7
民生	▲5		

※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

[2025年度 上期] 実績 セグメント別 (YoY)

(単位：億円)

		FY2025 1H 実績	FY2024 1H 実績	増減額	増減率
LSI	売上	1,142	1,042	+100	+9.6%
	セグメント利益	129	55	+74	+134.2%
	(利益率)	(11.3%)	(5.3%)	-	-
半導体素子	売上	999	972	+27	2.8%
	セグメント利益	▲98	▲104	+6	-
	(利益率)	(▲9.8%)	(▲10.7%)	-	-
モジュール	売上	171	177	▲6	▲3.4%
	セグメント利益	24	21	+3	+13.1%
	(利益率)	(14.2%)	(12.1%)	-	-
その他	売上	128	127	+1	+0.8%
	セグメント利益	20	15	+5	+34.6%
	(利益率)	(16.0%)	(12.0%)	-	-

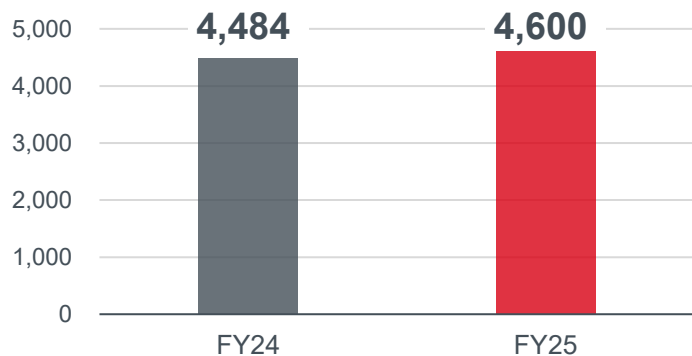
[2025年度 通期 市場別] 売上の変動要因 (YoY)

(単位：億円)



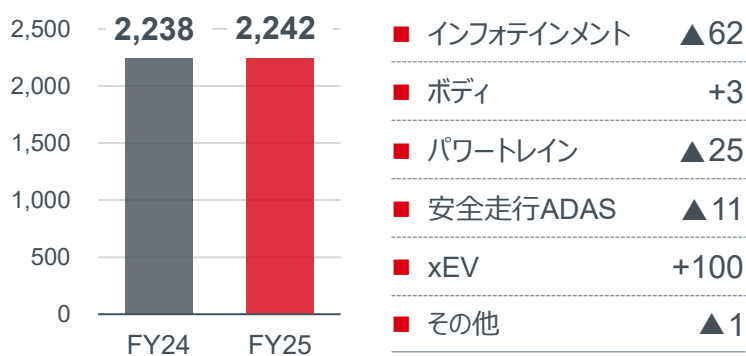
通期売上高

+2.6%



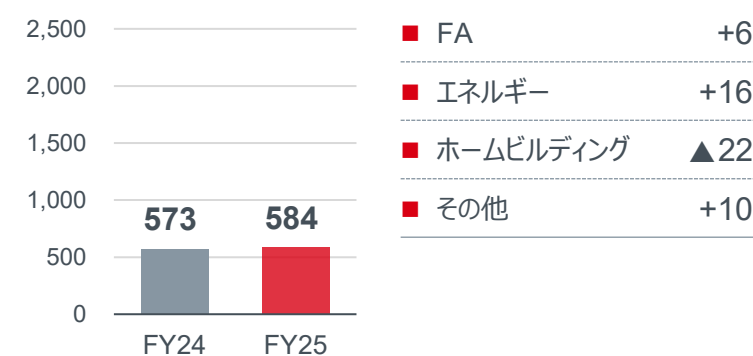
自動車

+0.2%



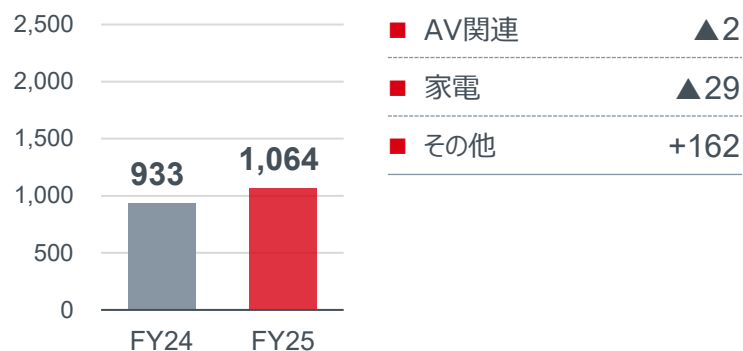
産機

+1.9%



民生

+14.0%



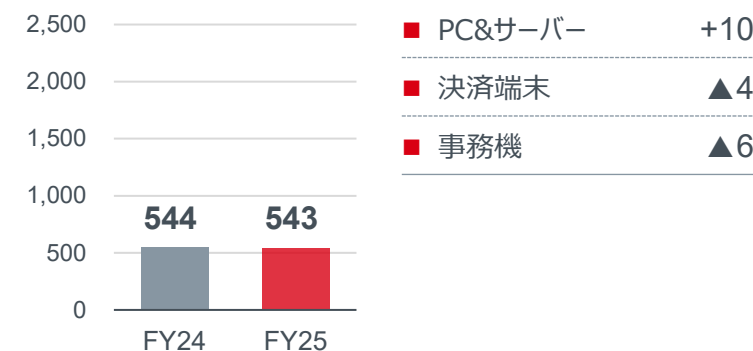
通信

▲14.9%



コンピュータ & ストレージ

▲0.1%



[2025年度 通期 国籍別] 売上の変動要因 (YoY)

通期
売上高

4,484億円

FY2024 実績

4,600億円

FY2025 計画

+2.6%

海外売上高
比率

47.7%

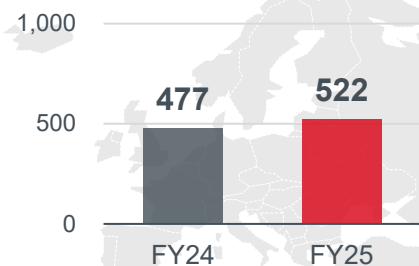
FY2024 実績

47.1%

FY2025 計画

欧州

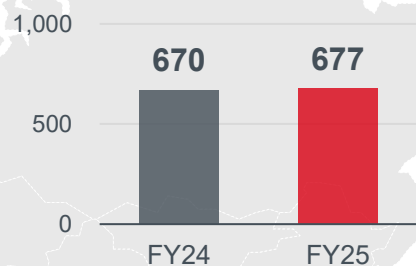
+9.4%



自動車	+30	通信	+0
産機	+15	C & S	+3
民生	▲3		

中国

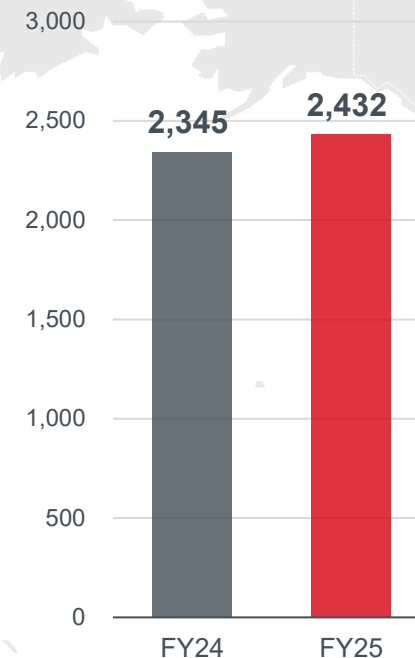
+1.0%



自動車	+23	通信	+2
産機	▲10	C & S	▲2
民生	▲6		

日本

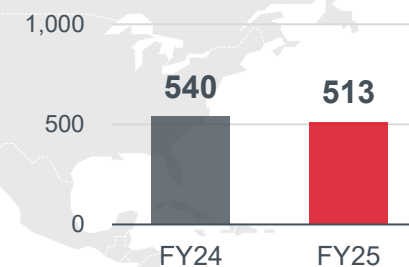
+3.7%



自動車	▲37	通信	▲8
産機	▲16	C & S	▲13
民生	+161		

米州

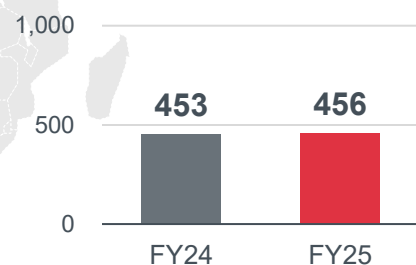
▲4.9%



自動車	▲2	通信	▲21
産機	+9	C & S	▲5
民生	▲8		

その他アジア

+0.6%



自動車	▲10
産機	+13
民生	▲13
通信	▲3
C & S	+16

※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

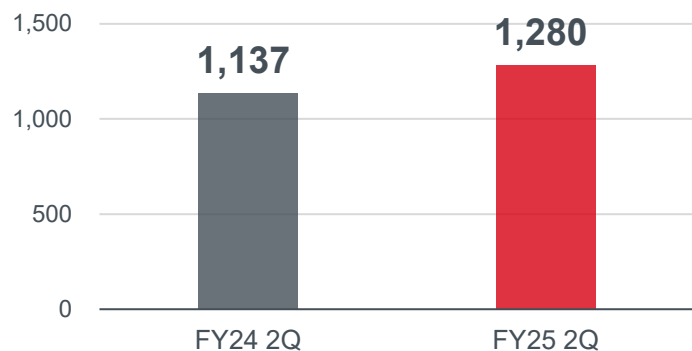
〔2025年度 第2四半期 市場別〕 売上の変動要因 (YoY)

(単位：億円)



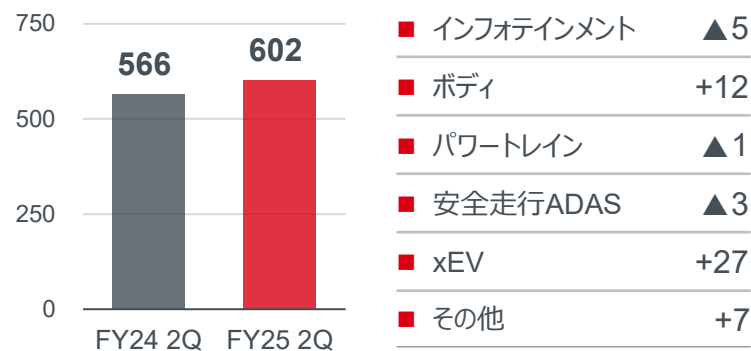
四半期売上高

+12.6%



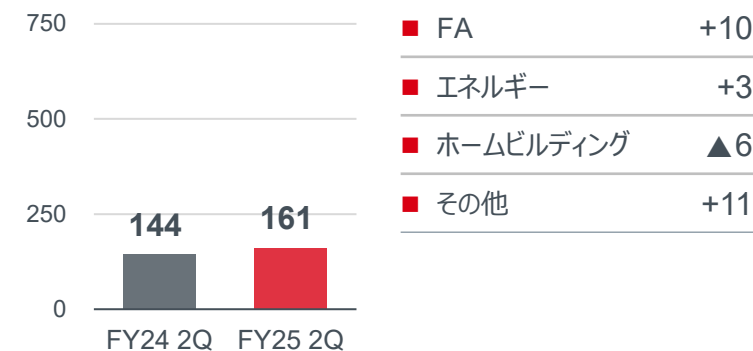
自動車

+6.4%



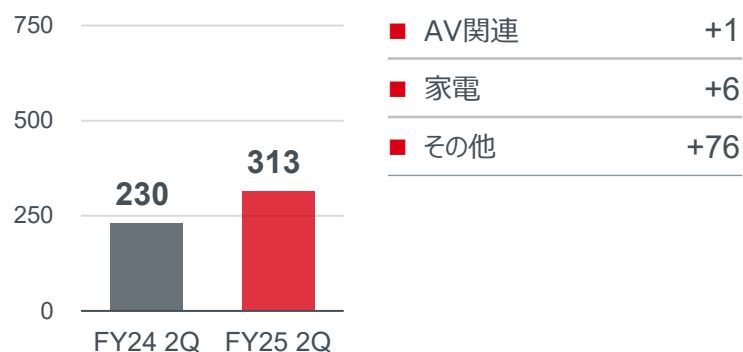
産機

+12.0%



民生

+36.0%



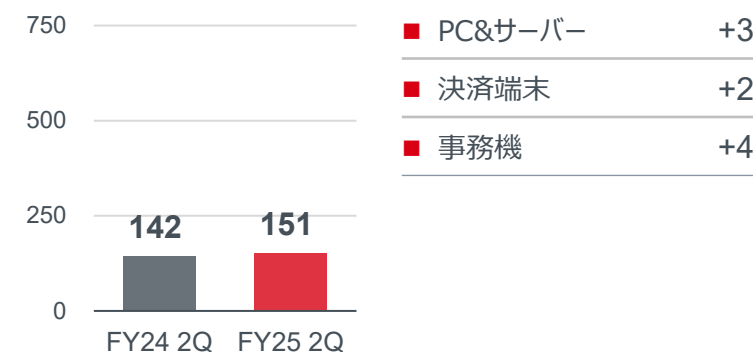
通信

▲4.3%



コンピュータ & ストレージ

+6.2%



[2025年度 第2四半期 国籍別] 売上の変動要因 (YoY)

四半期
売上高

1,137億円

FY2024 2Q実績

1,280億円

FY2025 2Q実績

+12.6%

海外売上高
比率

49.4%

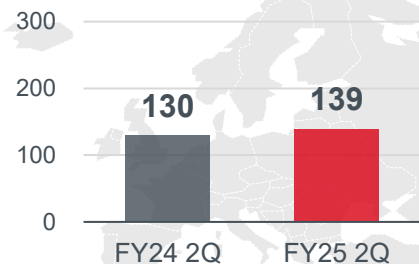
FY2024 2Q実績

46.7%

FY2025 2Q実績

欧州

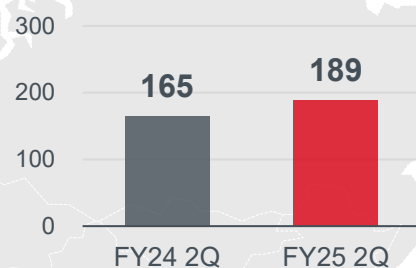
+7.1%



自動車	+8	通信	+0
産機	+1	C & S	+2
民生	▲1		

中国

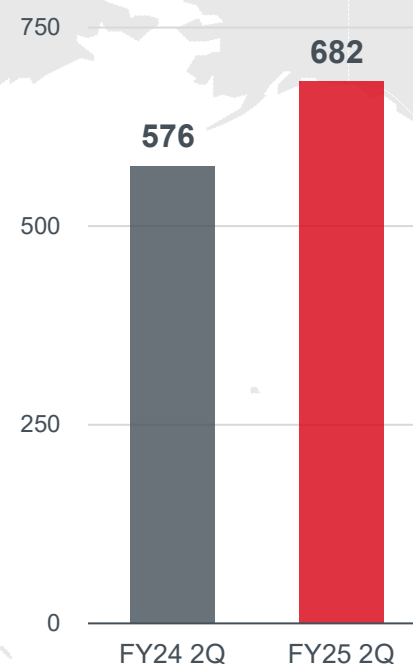
+14.3%



自動車	+9	通信	+3
産機	+0	C & S	+4
民生	+7		

日本

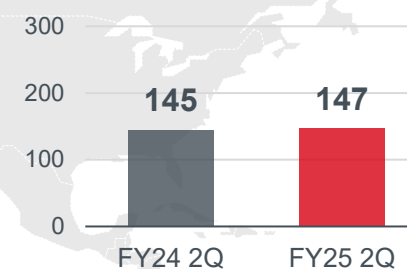
+18.5%



自動車	+15	通信	▲1
産機	+6	C & S	+0
民生	+86		

米州

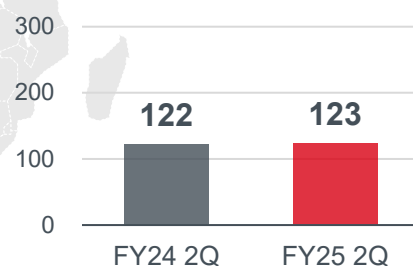
+1.1%



自動車	+2	通信	▲3
産機	+7	C & S	+0
民生	▲4		

その他アジア

+1.5%



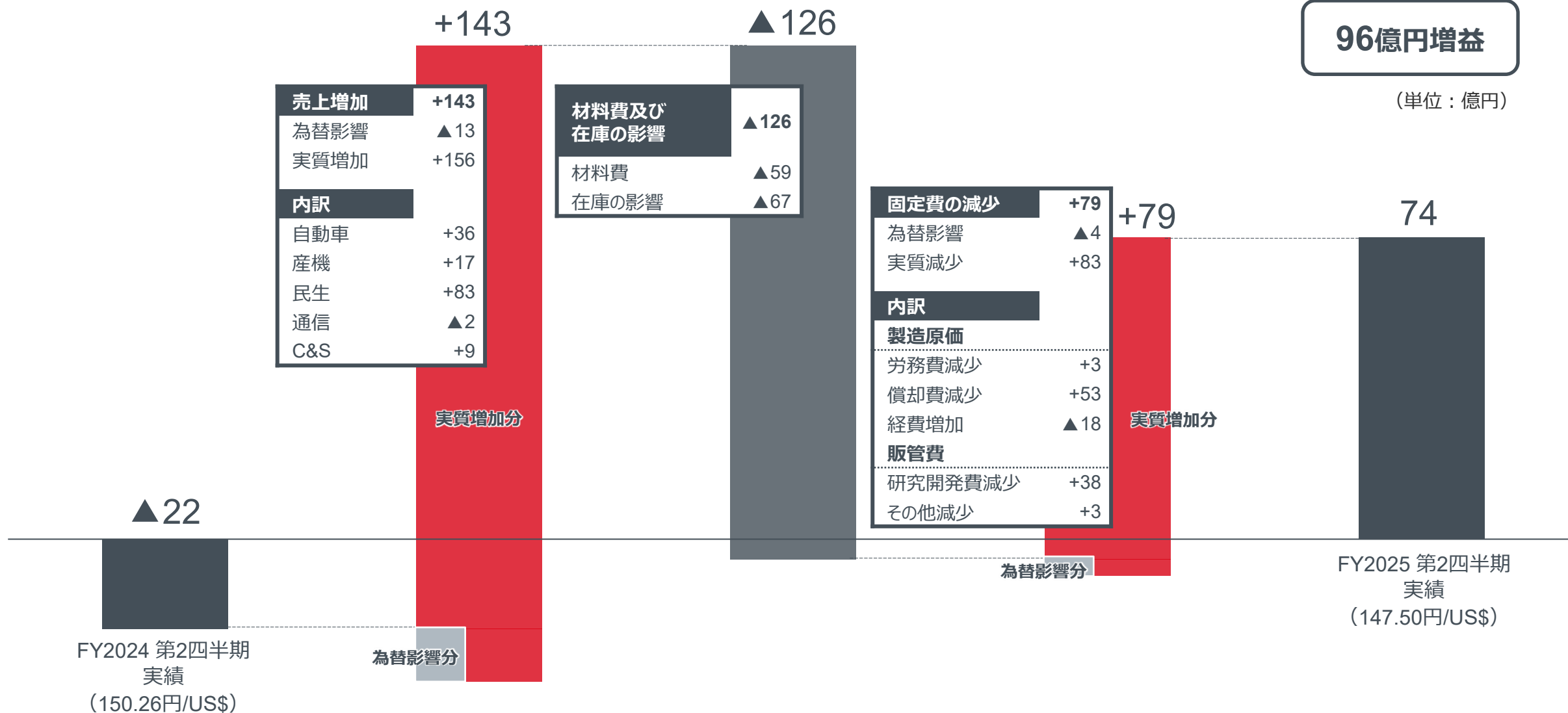
自動車	+3
産機	+3
民生	▲5
通信	▲1
C & S	+2

※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

[2025年度 第2四半期] 営業利益 増減分析 (YoY)

96億円増益

(単位：億円)



[2025年度 第2四半期] 実績 セグメント別 (YoY)

(単位：億円)

		FY2025 2Q 実績	FY2024 2Q 実績	増減額	増減率
LSI	売上	594	504	+90	+17.7%
	セグメント利益	86	15	+71	+464.3%
	(利益率)	(14.5%)	(3.0%)	-	-
半導体素子	売上	529	483	+46	9.5%
	セグメント利益	▲35	▲54	+19	-
	(利益率)	(▲6.7%)	(▲11.3%)	-	-
モジュール	売上	91	87	+4	+3.9%
	セグメント利益	15	13	+2	+15.3%
	(利益率)	(17.2%)	(15.5%)	-	-
その他	売上	65	61	+4	+6.7%
	セグメント利益	10	8	+2	+25.6%
	(利益率)	(15.8%)	(13.4%)	-	-

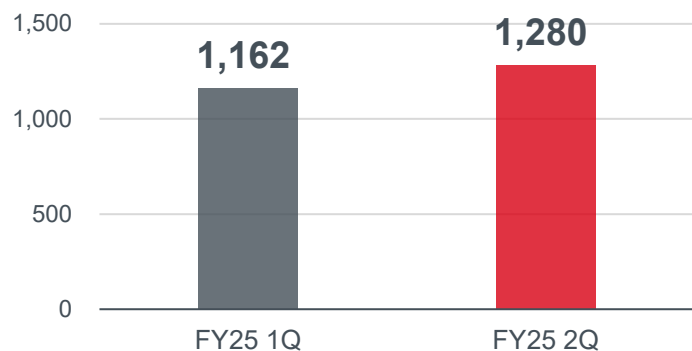
〔2025年度 第2四半期 市場別〕 売上の変動要因 (QoQ)

(単位：億円)



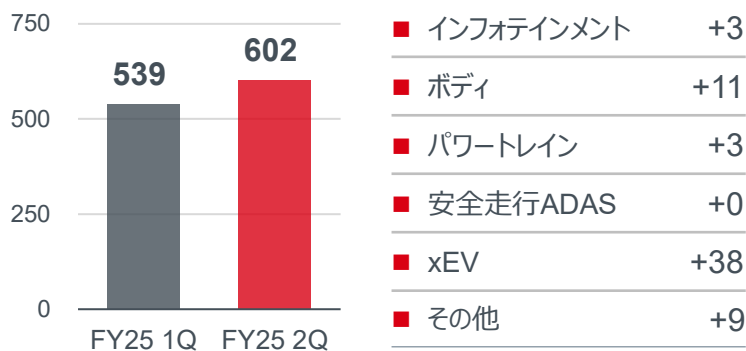
四半期売上高

+10.2%



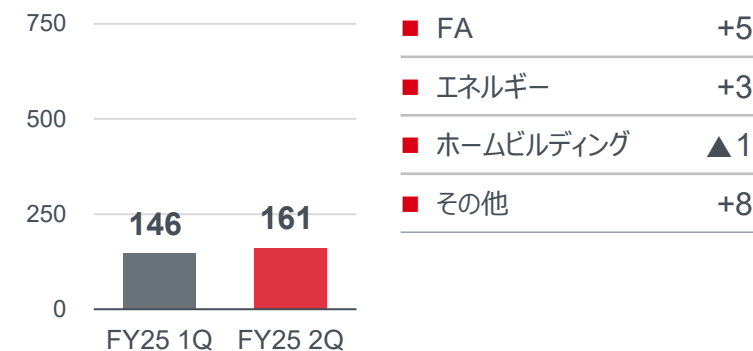
自動車

+11.7%



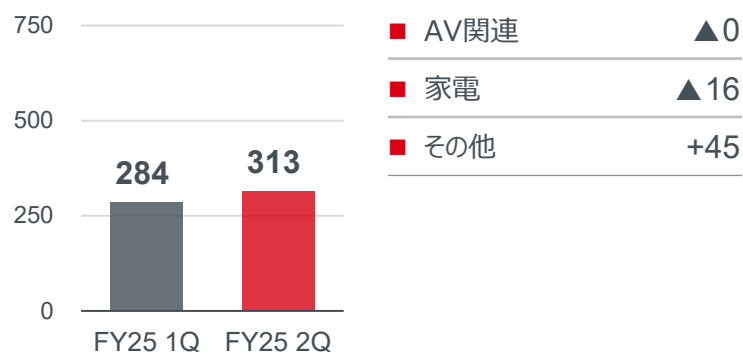
産機

+10.1%



民生

+10.1%



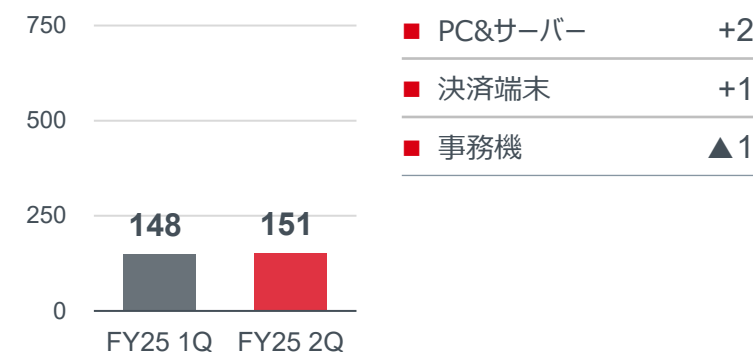
通信

+21.5%



コンピュータ & ストレージ

+1.5%



[2025年度 第2四半期 国籍別] 売上の変動要因 (QoQ)

四半期
売上高

1,162億円

FY2025 1Q実績

1,280億円

FY2025 2Q実績

+10.2%

海外売上高
比率

47.1%

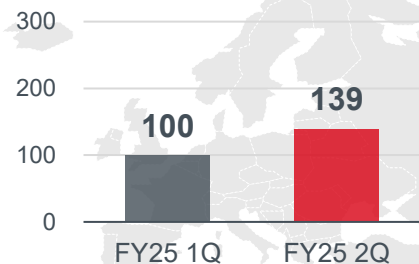
FY2025 1Q実績

46.7%

FY2025 2Q実績

欧州

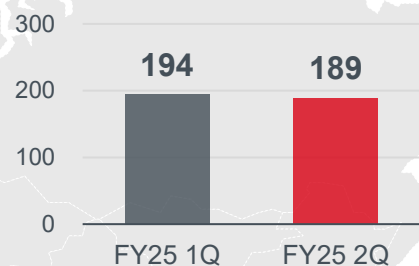
+39.5%



自動車	+36	通信	+0
産機	+3	C & S	+1
民生	▲0		

中国

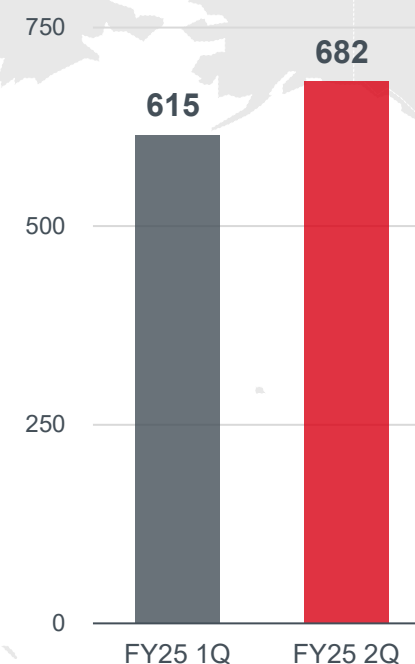
▲2.6%



自動車	+3	通信	+2
産機	▲1	C & S	+1
民生	▲10		

日本

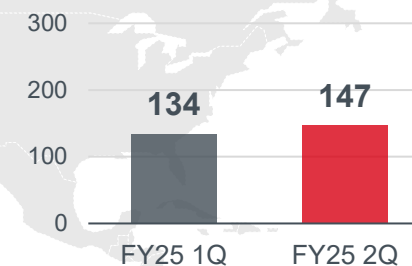
+10.9%



自動車	+19	通信	▲0
産機	+5	C & S	▲1
民生	+44		

米州

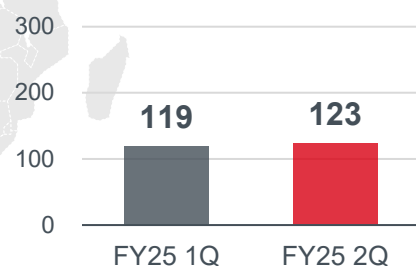
+9.4%



自動車	+2	通信	+8
産機	+4	C & S	+0
民生	▲1		

その他アジア

+3.6%



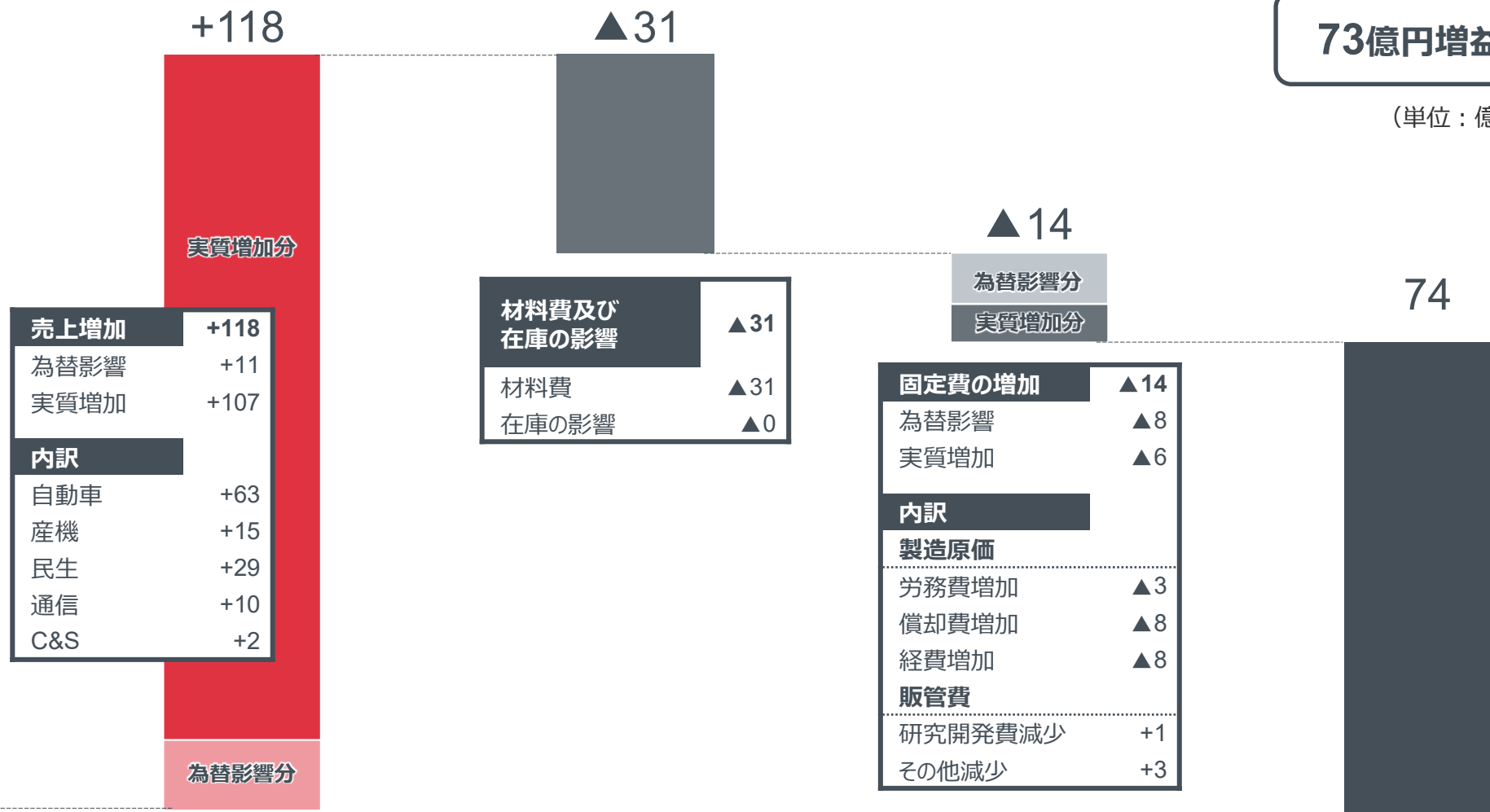
自動車	+3	通信	▲0
産機	+4	C & S	+2
民生	▲4		

※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

[2025年度 第2四半期] 営業利益 増減分析 (QoQ)

73億円増益

(単位：億円)



FY2025 第1四半期
実績
(145.19円/US\$)

FY2025 第2四半期
実績
(147.50円/US\$)

[2025年度 第2四半期] 実績 セグメント別 (QoQ)

(単位：億円)

		FY2025 2Q 実績	FY2025 1Q 実績	増減額	増減率
LSI	売上	594	548	+46	+8.4%
	セグメント利益	86	43	+43	+99.3%
	(利益率)	(14.5%)	(7.9%)	-	-
半導体素子	売上	529	470	+59	12.4%
	セグメント利益	▲35	▲62	+27	-
	(利益率)	(▲6.7%)	(▲13.3%)	-	-
モジュール	売上	91	79	+12	+14.4%
	セグメント利益	15	8	+7	+82.7%
	(利益率)	(17.2%)	(10.8%)	-	-
その他	売上	65	63	+2	+3.8%
	セグメント利益	10	10	+0	+2.0%
	(利益率)	(15.8%)	(16.1%)	-	-